



Institut
Mines-Télécom

Introduction aux alimentations et à l'ultra- basse consommation

... ou « tu pousses le bouchon un peu
trop loin Maurice »

Alexis Polti



Licence de droits d'usage



Contexte académique } sans modification

Par le téléchargement ou la consultation de ce document, l'utilisateur accepte la licence d'utilisation qui y est attachée, telle que détaillée dans les dispositions suivantes, et s'engage à la respecter intégralement.

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage sur le document consulté ou téléchargé, totalement ou en partie, dans les conditions définies ci-après, et à l'exclusion de toute utilisation commerciale.

Le droit d'usage défini par la licence autorise un usage dans un cadre académique, par un utilisateur donnant des cours dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur et à l'exclusion expresse des formations commerciales et notamment de formation continue. Ce droit comprend :

- le droit de reproduire tout ou partie du document sur support informatique ou papier,
- le droit de diffuser tout ou partie du document à destination des élèves ou étudiants.

Aucune modification du document dans son contenu, sa forme ou sa présentation n'est autorisée.

Les mentions relatives à la source du document et/ou à son auteur doivent être conservées dans leur intégralité.

Le droit d'usage défini par la licence est personnel, non exclusif et non transmissible.

Tout autre usage que ceux prévus par la licence est soumis à autorisation préalable et expresse de l'auteur :

alexis.polti@telecom-paristech.fr

tl;dr



● Ce qu'on va apprendre :

- Ce qu'est une alimentation, les grands types.
- Qu'une pile, c'est pas la joie.
- Que dormir, c'est bien.
- Plus généralement, un premier aperçu de comment faire un système embarqué « ultra basse consommation », d'un point de vue matériel et logiciel.

● Alimentation en tension :

- Dispositif, qui à partir d'une source d'énergie, fournit une tension aussi indépendante que possible du courant débité:
- Elle doit avoir une impédance de sortie nulle : $V_s = cste, \forall I$

● En pratique, $V_s = V_s(V_e, I)$, d'où $dV_s = \frac{\partial V_s}{\partial V_e} \cdot dV_e + \frac{\partial V_s}{\partial I} \cdot dI$

● coefficient de stabilité : $\frac{\partial V_s}{\partial V_e}$

● impédance de sortie : $\frac{\partial V_s}{\partial I}$

● alimentation idéale : les deux sont nuls.

Nous nous intéresserons uniquement aux alimentations les plus fréquemment utilisées dans les systèmes embarqués : alimentations à tension continue.

Définitions

● Efficacité : $\eta = \frac{P_o}{P_i}$ $0 \leq \eta \leq 1$

● Line regulation :

● Variation de la tension de sortie en fonction des variations de la tension d'entrée. Généralement en $\% \cdot V^{-1}$

● $\frac{1}{V_s} \cdot \frac{\partial V_s}{\partial V_e}$

● Load regulation :

● Variation de la tension de sortie en fonction des variations du courant de sortie.

● Similaire à l'impédance de sortie.

● $\frac{1}{V_s} \cdot \frac{\partial V_s}{\partial I}$

● Drop-out :

● tension minimum entre entrée et sortie pour que l'alimentation fonctionne.

● typiquement 0.15V – 3V

● Tension de bruit en sortie

● valeur efficace de la tension de bruit en sortie

● Ripple rejection ratio (RRR)

● facteur de réjection d'une ondulation de faible amplitude en entrée

● exprimé en dB

● $RRR_{dB} = 20 \cdot \log \frac{|\Delta V_{s_{max}}|}{|\Delta V_{e_{max}}|}$

● Remarques générales :

- la tension d'alimentation d'un circuit intégré est souvent donnée à 5% près :
 - $V_{cc} = 3.3V$, précision = 165mV
 - $V_{cc} = 1.5V$, précision = 75mV
- Cette tension doit être maintenue, même lors de pics de consommation qui peuvent atteindre plusieurs ampères en quelques microsecondes (rafraîchissement de RAM par exemple).
- Les alimentations sont souvent le point le plus critique d'un système embarqué.
- Contraintes :
 - stabilité
 - précision
 - efficacité
 - coût
- Impliquent des calculs souvent pénibles et compliqués, ainsi qu'une phase de test longue.

Où en est-on ?



● **Les alimentations**

- définitions
- ● régulateurs linéaires
- régulateurs à découpage

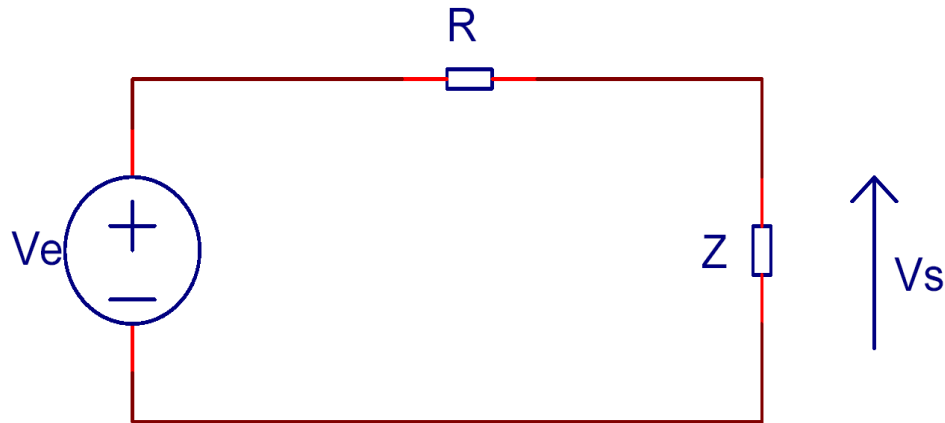
• Principe

- la conversion de tension est obtenue en dissipant une partie de la puissance d'entrée dans un élément chauffant.
- $V_s < V_e$
- 4 types
 - résistance
 - diode zener : référence de tension
 - transistor ballast
 - à contre-réaction

• Résistance série

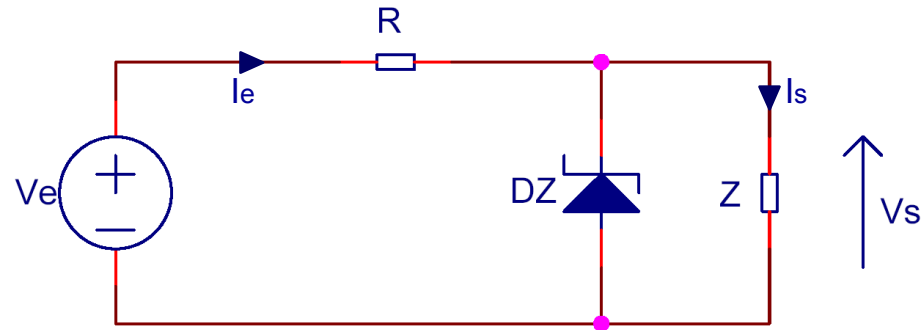
$$V_s = V_e \cdot \frac{Z}{Z + R}$$

$$\eta = \frac{Z}{Z + R} = \frac{V_s}{V_e}$$



- Impédance de sortie élevée (R).
- Rendement mauvais.
- Pas vraiment une « alimentation » !

• Diode Zener



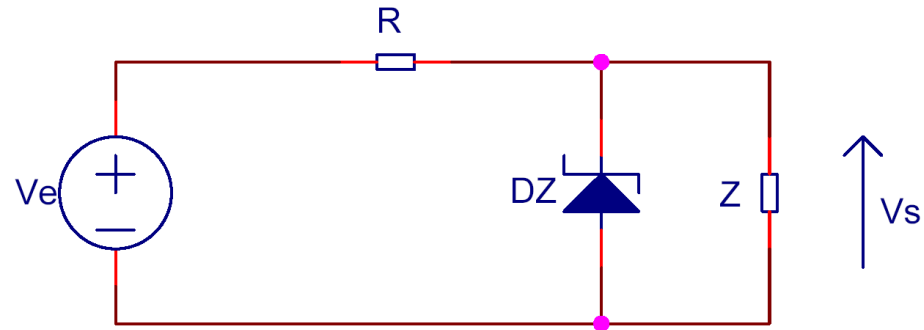
- DZ ne conduit que si $Z > \frac{V_Z}{V_e - V_Z} \cdot R \Leftrightarrow I_s < \frac{V_e - V_Z}{R}$

- statique : $V_s = V_Z + R_Z \cdot (I_e - I_s)$

$$V_s = \frac{R}{R + R_Z} \cdot V_Z + \frac{R_Z}{R + R_Z} \cdot V_e - \frac{R \cdot R_Z}{R + R_Z} \cdot I_s$$

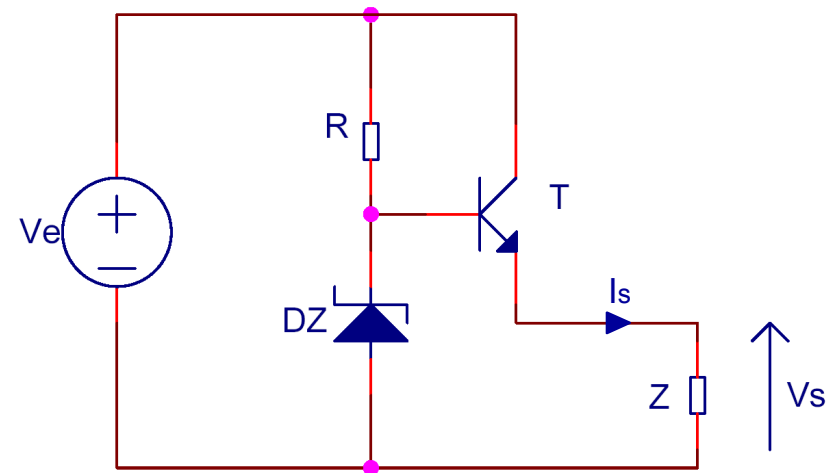
- dynamique : $dV_s = \frac{R_Z}{R + R_Z} \cdot dV_e - \frac{R_Z \cdot R}{R_Z + R} \cdot dI_s$

• Diode Zener



- Rendement pire que le précédent.
- Protection contre les surtensions et les courts-circuits
- Tension de sortie régulée pour les faibles courants :
 - Z grande
 - R_z est faible
- Utilisé comme référence de tension.

• Zener et ballast

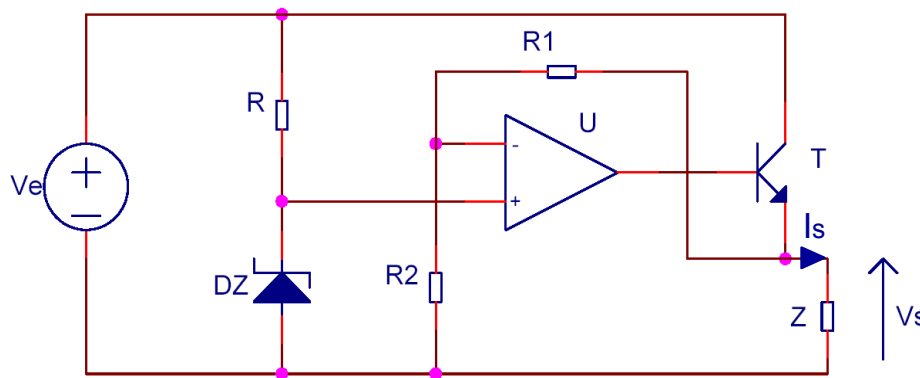


- Statique : $V_s = V_Z - V_{be} + R_Z \cdot I_s$

- Dynamique : $dV_s = \frac{R_Z}{R + R_Z} \cdot dV_e - \frac{1}{\beta + 1} \left(h_{11} + \frac{R \cdot R_Z}{R + R_Z} \right) \cdot dI_s$

- Équivalent au précédent, avec
 - impédance de sortie réduite,
 - courant de sortie plus élevé.

• Régulateur linéaire asservi



$$V_s = V_z \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

- Les plus rencontrés des régulateurs linéaires.
 - Souvent équipés de protection contre les courts-circuits.
 - Possibilité de brancher R en sortie de l'alimentation pour s'affranchir de dV_e .
- Possibilité d'oscillations :
 - nécessitent une capacité en sortie pour stabilité.

Où en est-on ?



• Les alimentations

- définitions
- régulateurs linéaires
- • régulateurs à découpage

● Principe

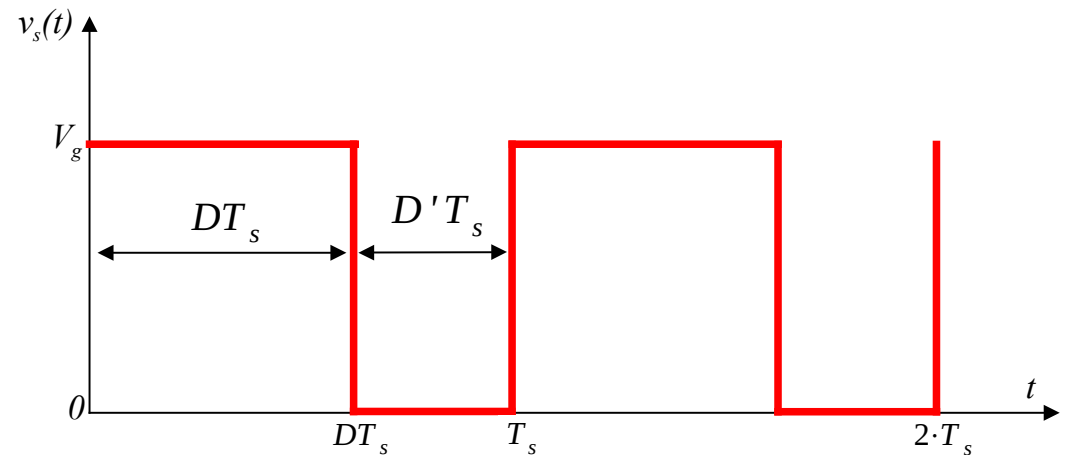
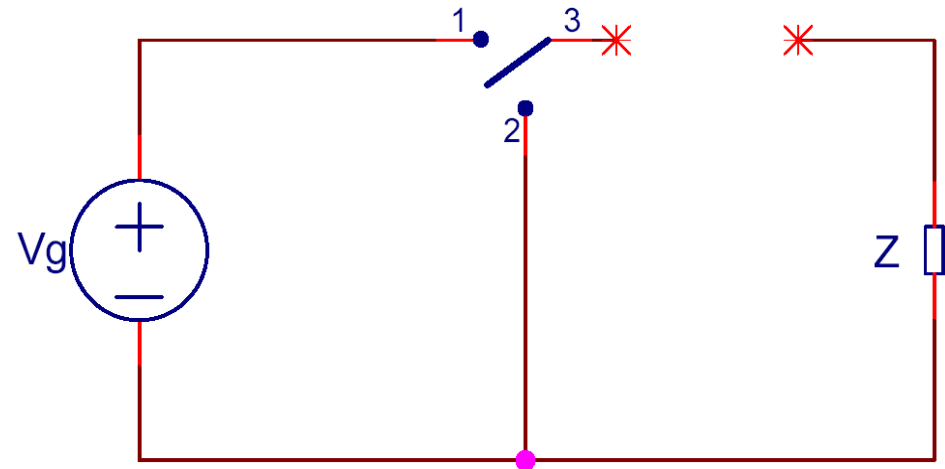
- On veut limiter les pertes : on n'utilise que des éléments non dissipatifs (en théorie)
 - interrupteurs
 - inductances, transformateurs
 - capacités
- Stockage de la puissance d'entrée, puis restitution
 - processus en deux (ou plus) phases : hachage
 - V_s peut être supérieur à V_e , son signe peut aussi être différent
 - processus non linéaire : étude difficile
- On se limitera à l'étude des convertisseurs DC-DC non isolés rencontrés usuellement dans les petits systèmes embarqués.

Alimentations à découpage

● Principe

● Rapport cyclique

$$D = \frac{T_{on}}{T_s}, D' = \frac{T_{off}}{T_s} \quad 0 \leq D \leq 1$$
$$D + D' = 1$$

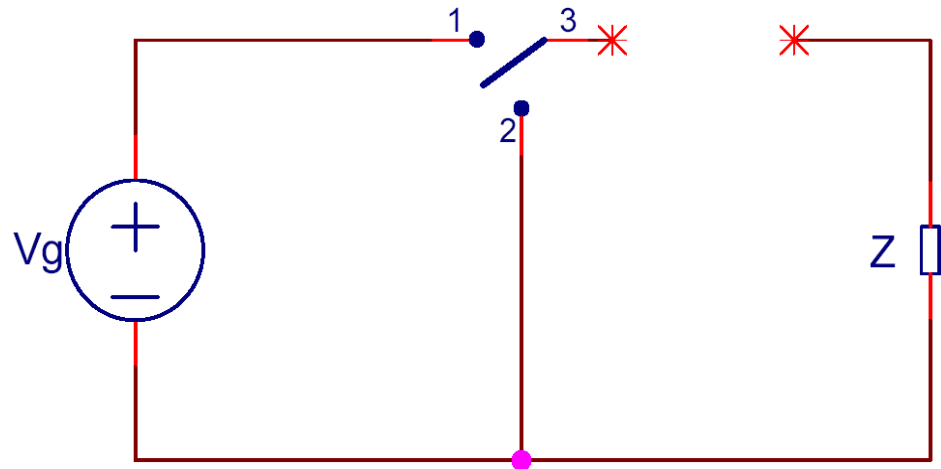


Alimentations à découpage

● Principe

● Rapport cyclique

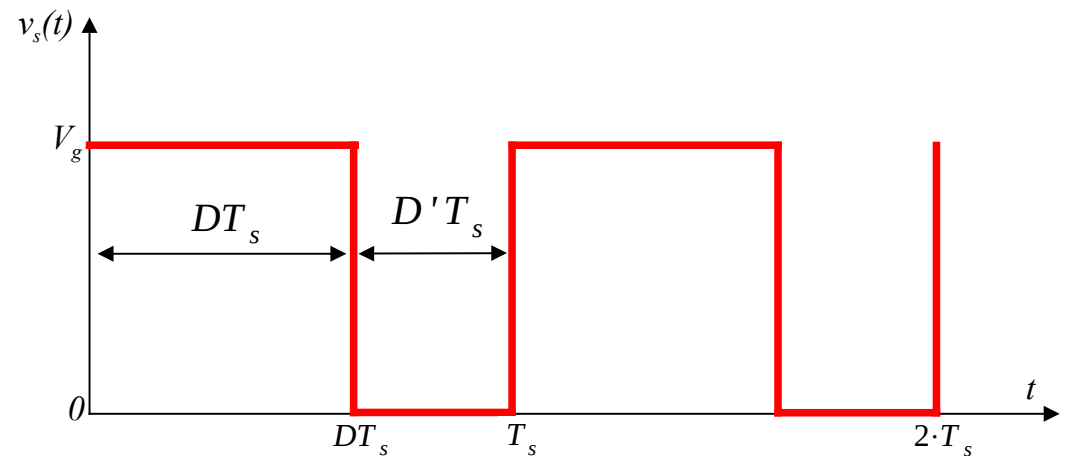
$$D = \frac{T_{on}}{T_s}, D' = \frac{T_{off}}{T_s} \quad 0 \leq D \leq 1$$
$$D + D' = 1$$



● Valeur moyenne

$$\langle v_s \rangle = \frac{1}{T_s} \cdot \int_{t_1}^{t_1 + T_s} v_s(t) dt$$

$$\langle v_s \rangle = D \cdot V_g$$

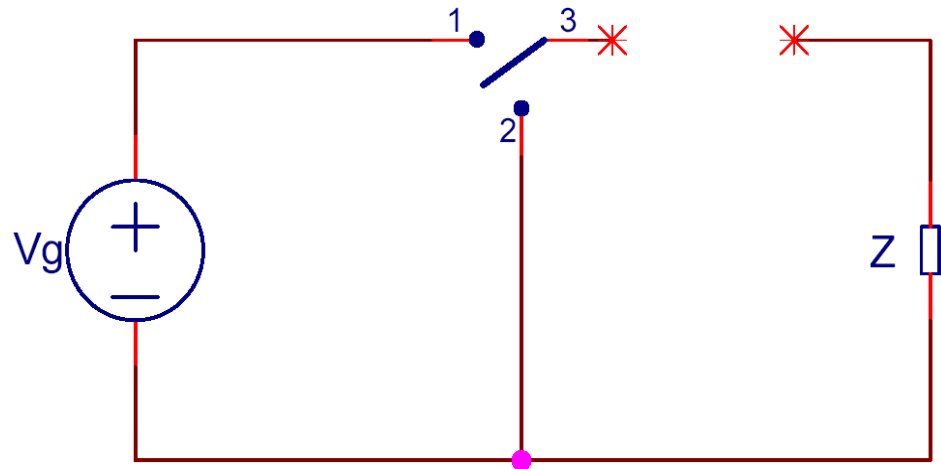


Alimentations à découpage

● Principe

● Rapport cyclique

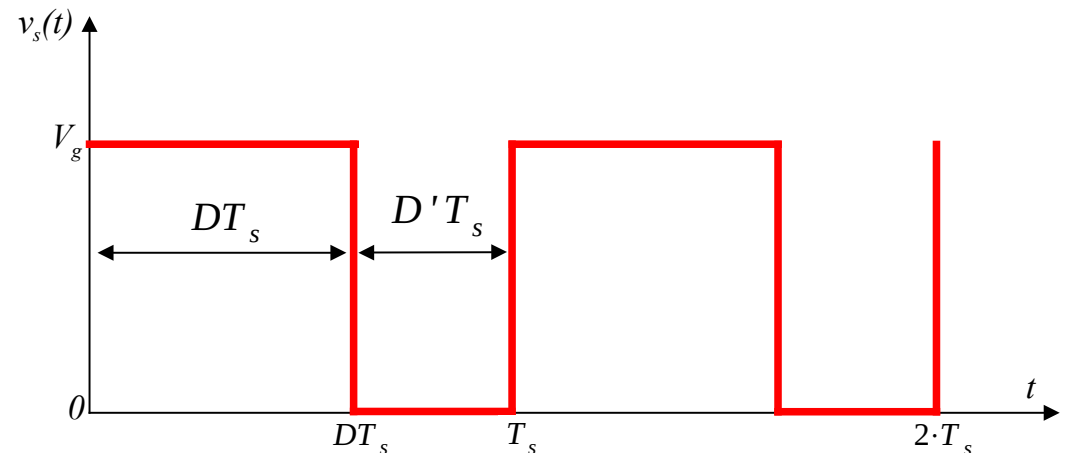
$$D = \frac{T_{on}}{T_s}, D' = \frac{T_{off}}{T_s} \quad 0 \leq D \leq 1$$
$$D + D' = 1$$



● Valeur moyenne

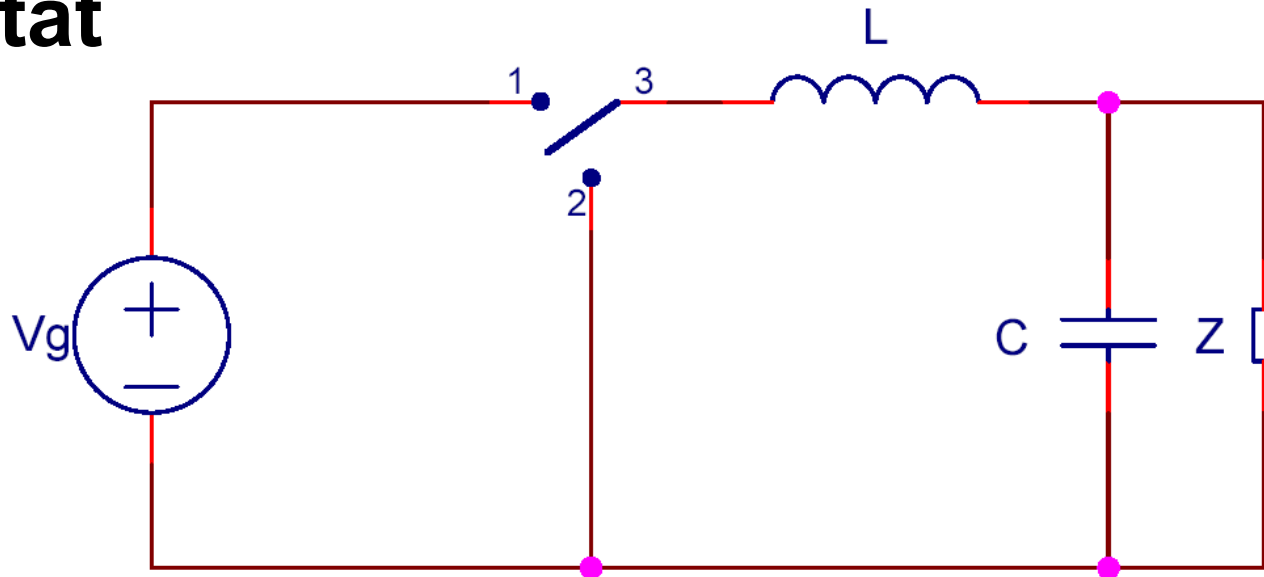
$$\langle v_s \rangle = \frac{1}{T_s} \cdot \int_{t_1}^{t_1+T_s} v_s(t) dt$$

$$\langle v_s \rangle = D \cdot V_g$$



● On ne garde que la composante continue : filtre passe-bas

• Résultat



- Étude en deux phases :
 - interrupteur en position 1
 - interrupteur en position 2

Alimentations à découpage

Étape 1

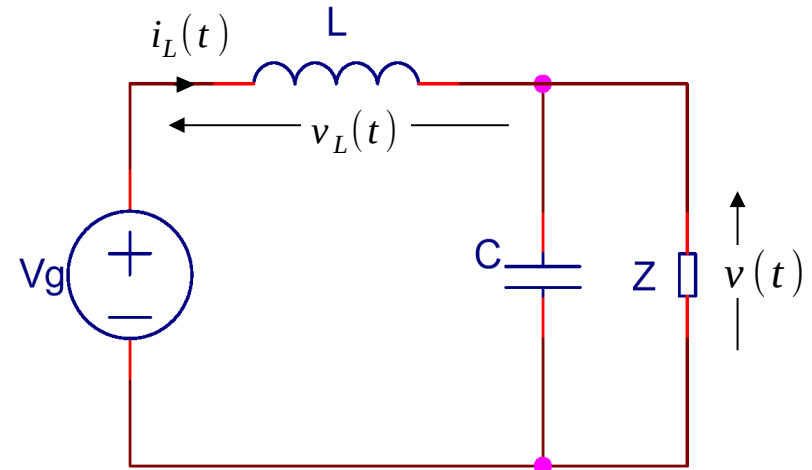
- tension aux bornes de l'inductance :

$$v_L = V_g - v(t)$$

- approximation : le convertisseur est calculé et contrôlé de façon à ce que la tension de sortie soit stable (régime permanent)

$$v_L = V_g - V$$

- courant dans l'inductance : $L \cdot \frac{di_L}{dt} = V_g - V = cste$
pente constante



Alimentations à découpage

Étape 2

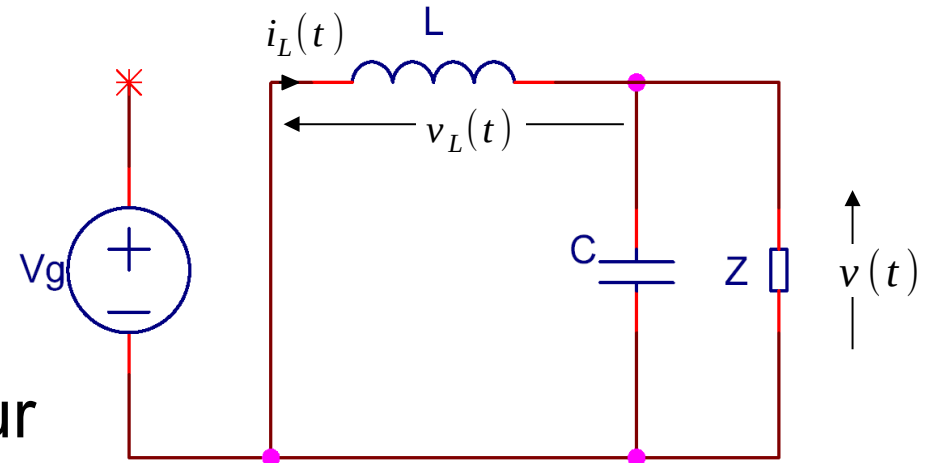
- tension aux bornes de l'inductance :

$$v_L = -v(t)$$

- approximation : le convertisseur est calculé et contrôlé de façon à ce que la tension de sortie soit stable (régime permanent)

$$v_L = -V$$

- courant dans l'inductance : $L \cdot \frac{di_L}{dt} = -V = cste$
pente constante



On rassemble le tout

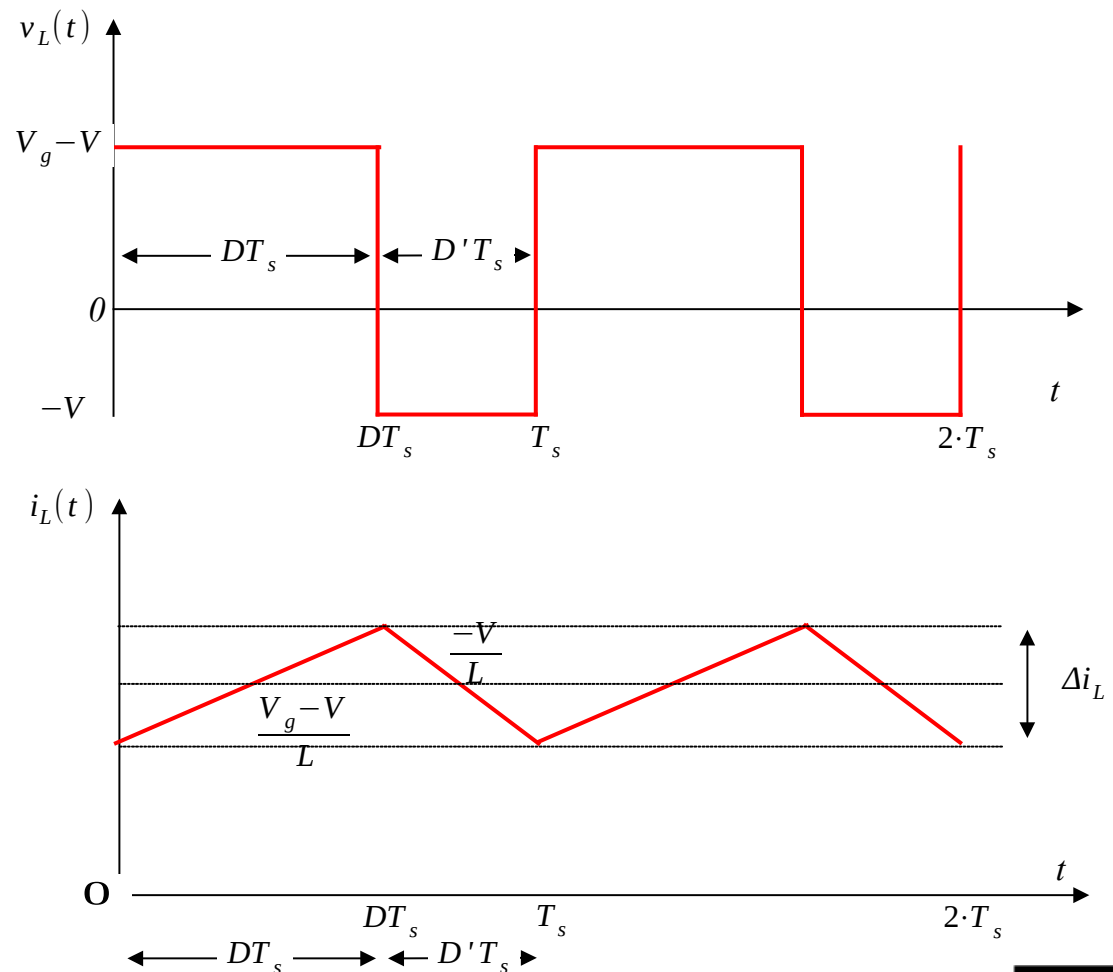
- Tension moyenne aux bornes de l'inductance :

$$\langle v_L \rangle = D \cdot (V_g - V) + D' \cdot (-V) = 0$$

$$V = D \cdot V_g$$

- Variation du courant dans l'inductance :

$$\Delta i_L = \frac{V_g - V}{L} \cdot D \cdot T_s = \frac{D \cdot D' \cdot V_g}{L \cdot f}$$



Alimentations à découpage

● Influence de la capacité de sortie

- Lissage de l'ondulation du courant dans l'inductance

$$\Delta v_C = \frac{D \cdot D' \cdot V_g}{8 \cdot L \cdot C \cdot f^2}$$

- Variations de charge rapides (moins d'un cycle) :

- la boucle n'ayant pas le temps de réagir, c'est la résistance série parasite (ESR) de C qui détermine les variations de tension de sortie

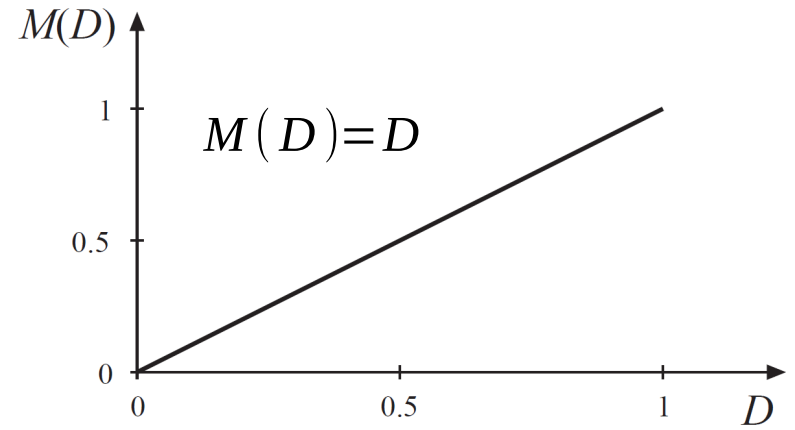
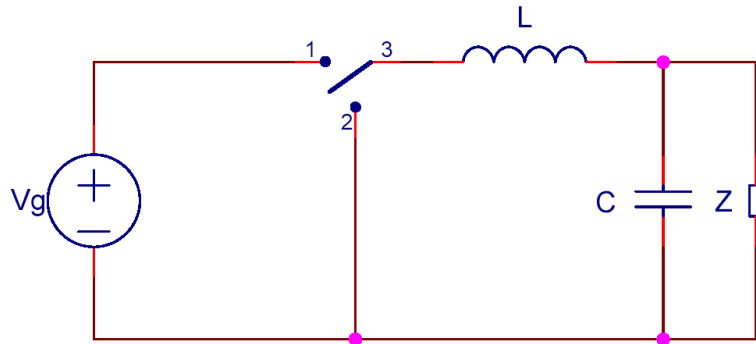
$$dv_C^{ESR} \approx R_{ESR} \cdot i_s \cdot dt$$

- En pratique :

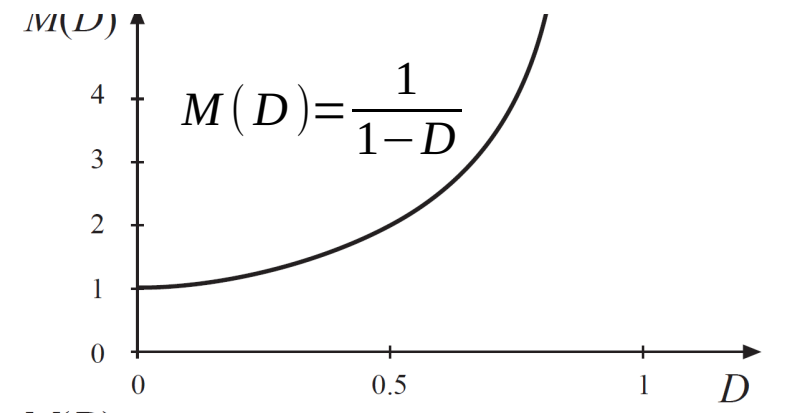
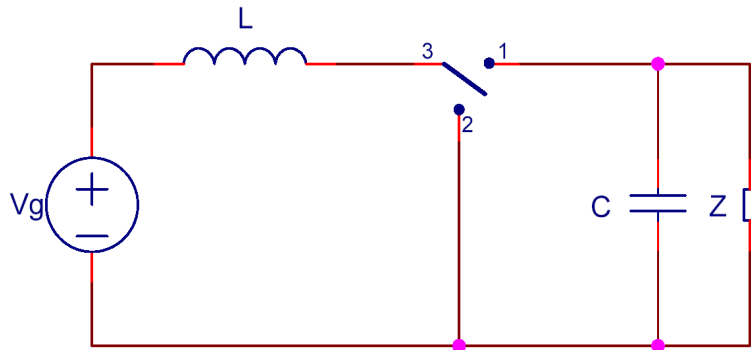
- L'ESR est totalement prédominante.
- Choisir des capacités à très faible ESR (céramique).
- Attention :
 - l'ESR influe sur la stabilité du régulateur (cf. l'année prochaine).
 - Vérifier que la capacité accepte bien une grosse variation de courant !

Trois topologies usuelles simples

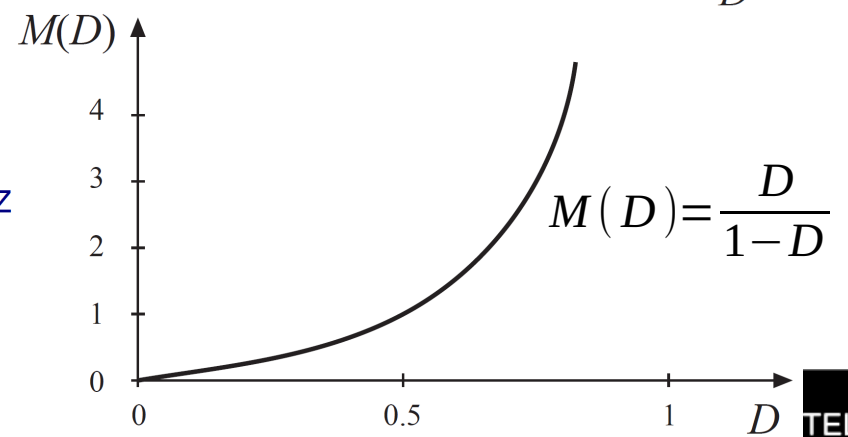
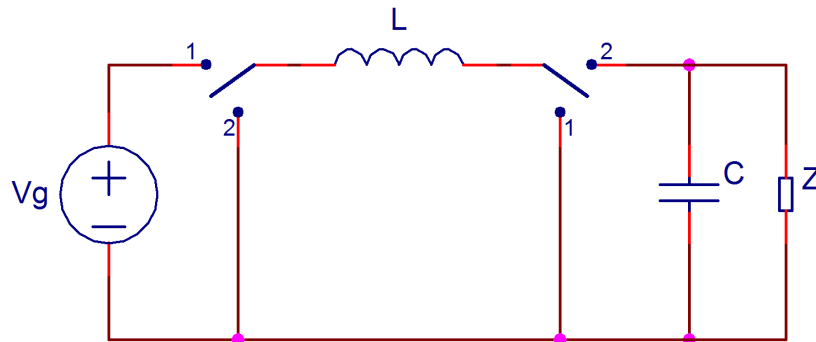
Buck



Boost



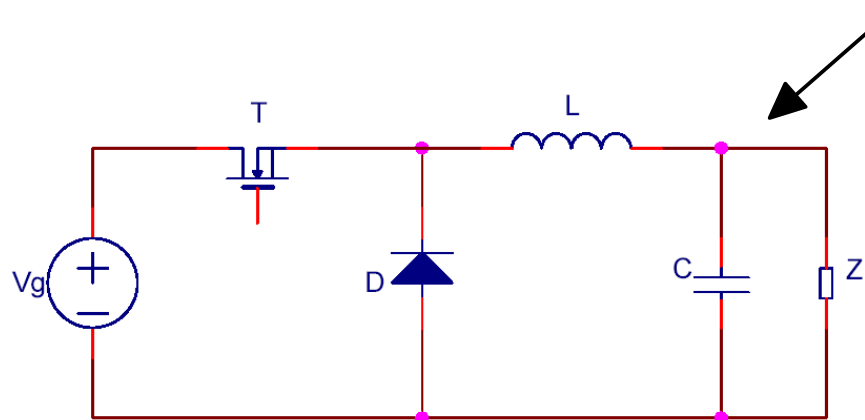
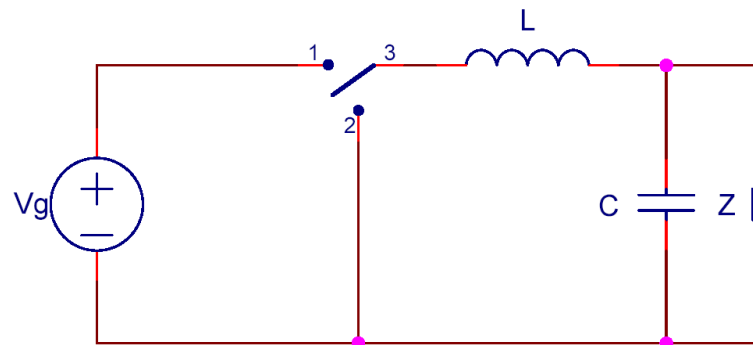
Buck-Boost
(non inverseur)



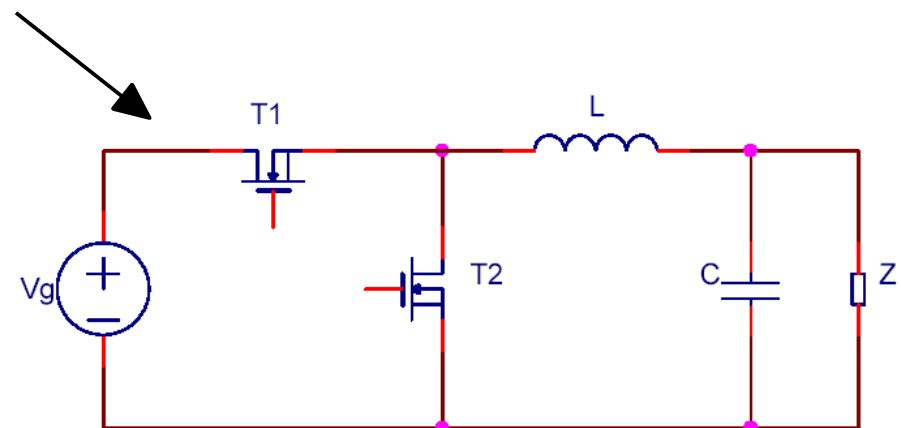
Alimentations à découpage

● Interrupteurs

- Selon les cas, deux possibilités : diode ou transistor.
- Exemple : buck



asynchrone



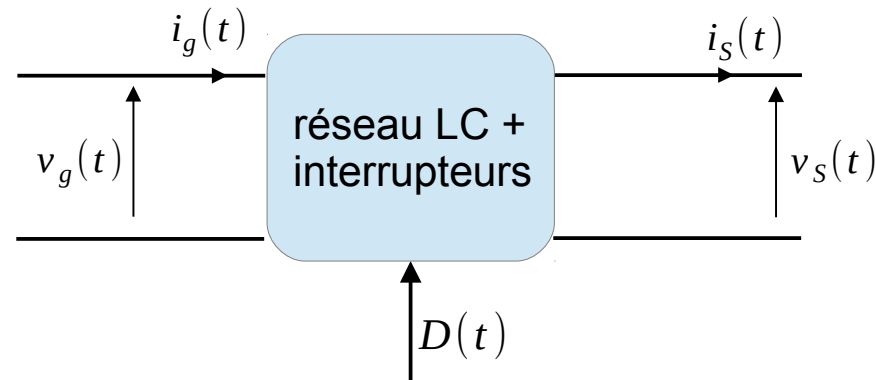
synchrone

Alimentations à découpage

- Synchrones
 - plus cher,
 - un seul mode de fonctionnement en 2 phases (CCM),
 - rendement souvent meilleur.
- Asynchrones
 - moins cher,
 - fonctionnement radicalement différent :
 - parfois 3 phases au lieu de 2
 - → 2 modes : CCM et DCM
 - rendement souvent moins bon que synchrone.

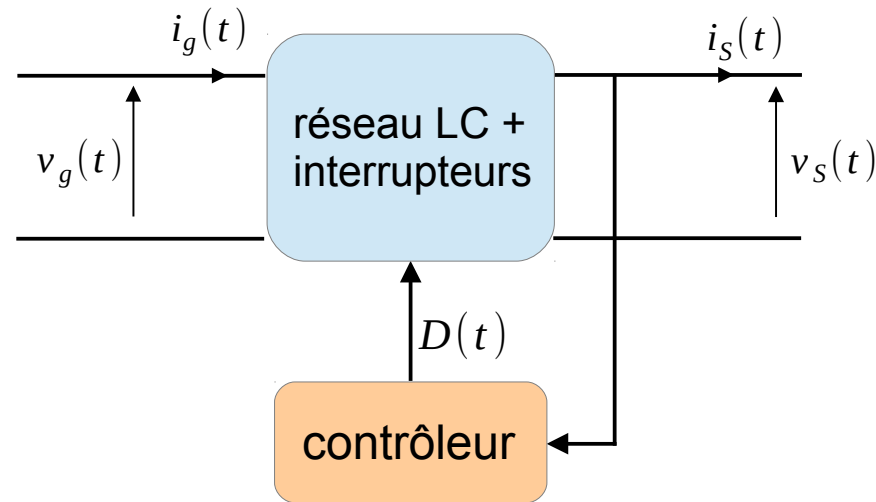
Contrôle des alimentations à découpage

● Contrôle



- Dans les modèles vus, le rapport de transformation $M(D)$ ne dépend que de D , le rapport cyclique, pas de
 - la charge,
 - la fréquence de découpage,
 - la tension d'entrée,
 - la valeur des composants.
- En pratique (régime non permanent), on veut contrôler D de façon à rendre la tension de sortie V_s indépendante :
 - des variations de la tension d'entrée V_g ,
 - des variations du courant de sortie I_s ,
 - des variations de température, etc.

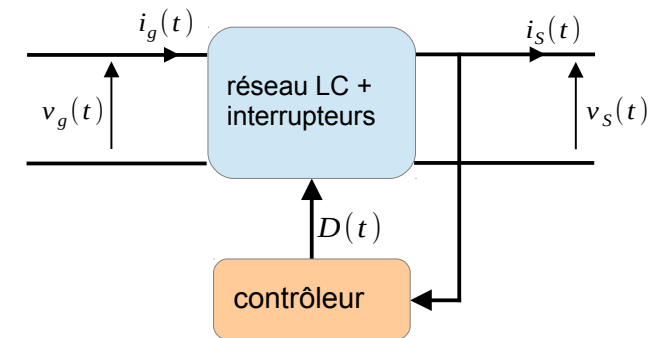
• Contrôle



- Étude du système bouclé :
 - il faut connaître les caractéristiques dynamiques du convertisseur (AC),
 - étudier la réponse du système en boucle ouverte,
 - le modifier de façon à ce qu'en boucle fermée il soit stable.

Contrôle des alimentations à découpage

• Deux stratégies principales



• VCM (Voltage Control Mode)

- On compare à chaque cycle la tension de sortie V_s à une tension de référence interne précise, et on ajuste D en conséquence.
- Simple.
- « Difficile » à rendre stable.

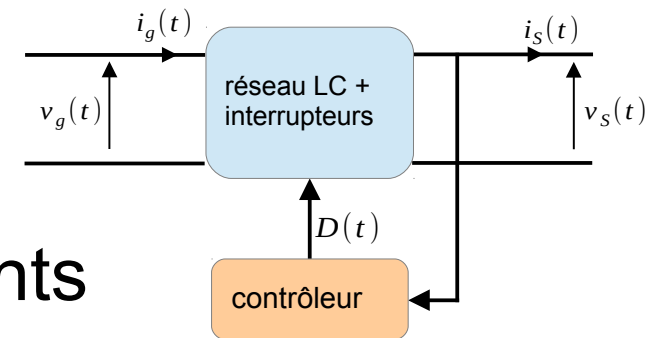
• CCM (Current Control Mode)

- On a deux boucle imbriquées : une interne rapide qui contrôle le courant dans l'inductance, et une externe plus lente similaire à celle du VCM.
- Plus complexe.
- Plus facile à stabiliser !

Contrôle des alimentations à découpage

• Dans les deux cas :

- La boucle de contre-réaction doit être stabilisée par ajout de composants externes, appelés « compensation ».
- La valeur de ces composants **doit être calculée** en fonction des paramètres de votre application.
 - → Ne jamais prendre les valeurs par défaut mises dans les datasheets !
 - Toujours faire des simulations et des tests.
- L'étude de la boucle et de sa compensation sera vue en détail en SE302.



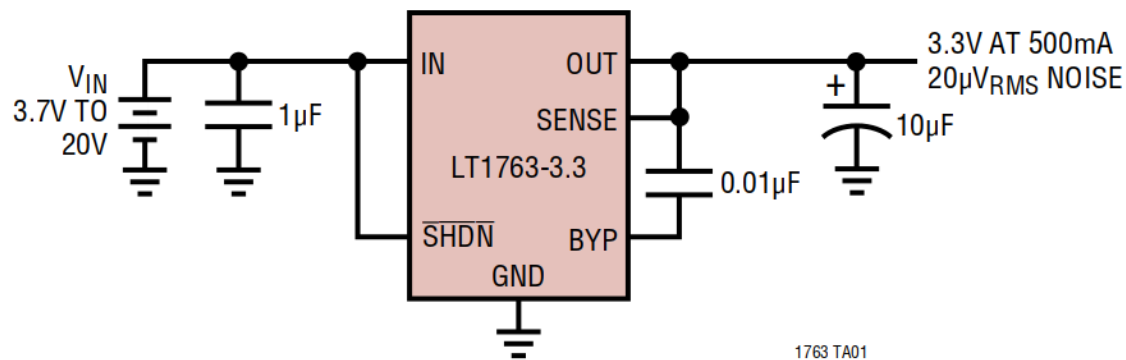
• Conclusion

- Ce sont des régulateurs à très haut rendement, très pratiques pour l'ultra-basse consommation.
- Complexes à mettre en œuvre proprement mais le jeu en vaut la chandelle.
- Bien lire les datasheets pour :
 - le choix de l'inductance,
 - le choix des capacités,
 - le choix des composants pour la compensation,
 - les consignes de placement-routage.
- Simuler, tester.

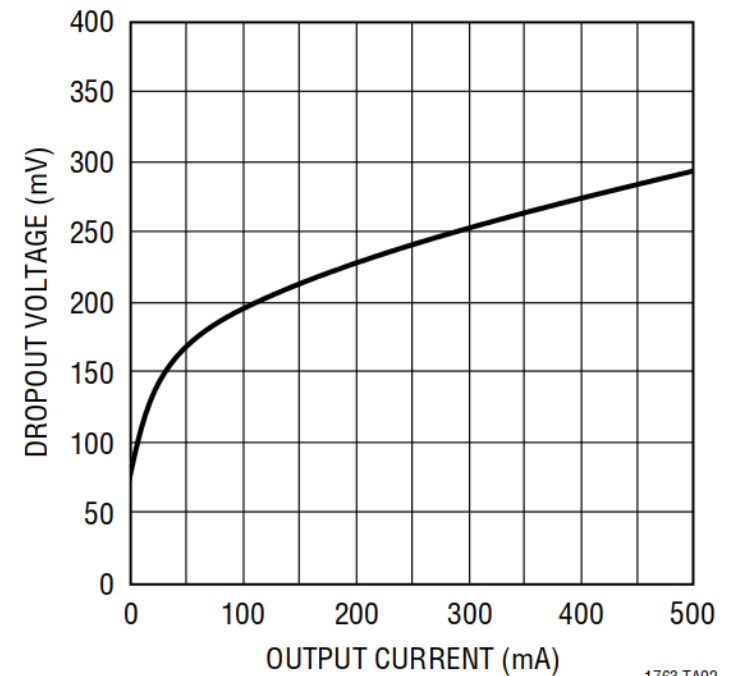
Exemples d'alimentations

Exemple : linéaire low-dropout (LT1763)

3.3V Low Noise Regulator

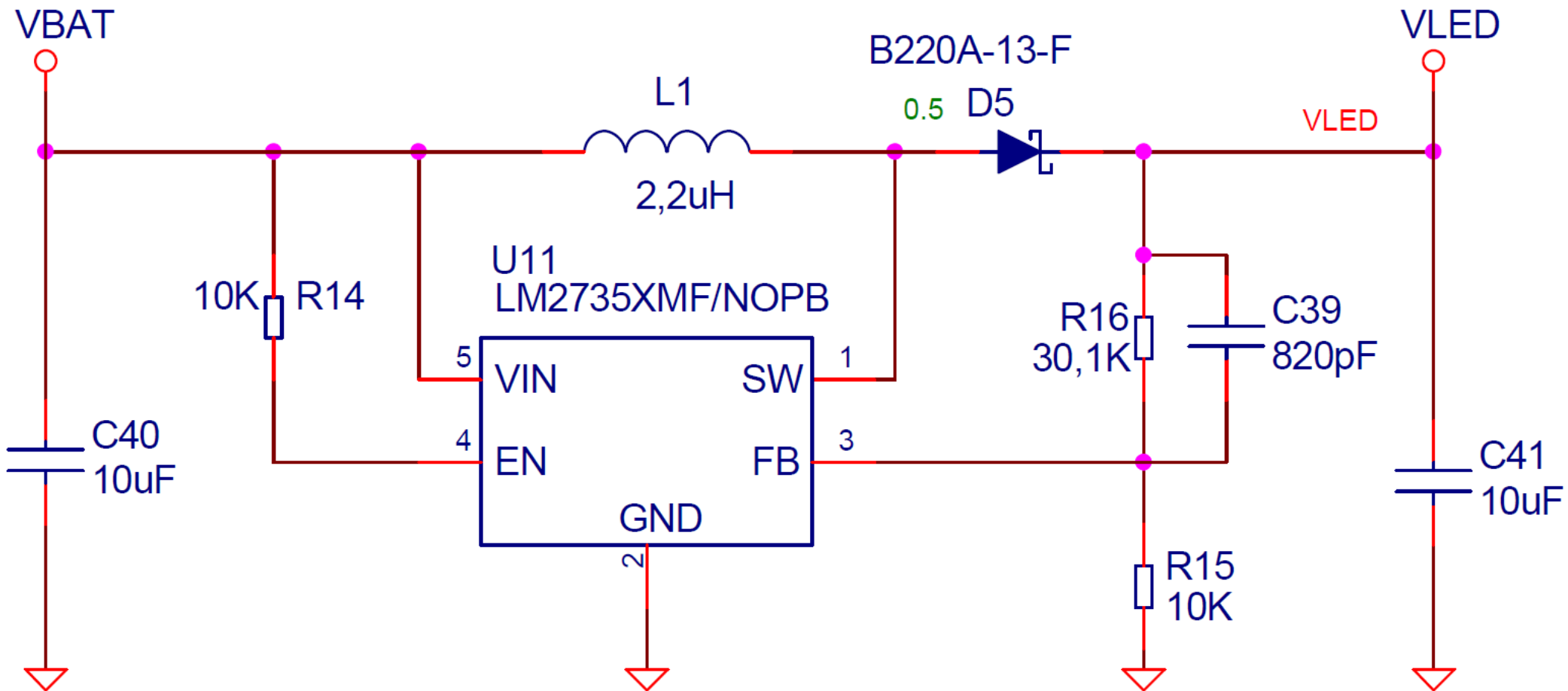


Dropout Voltage



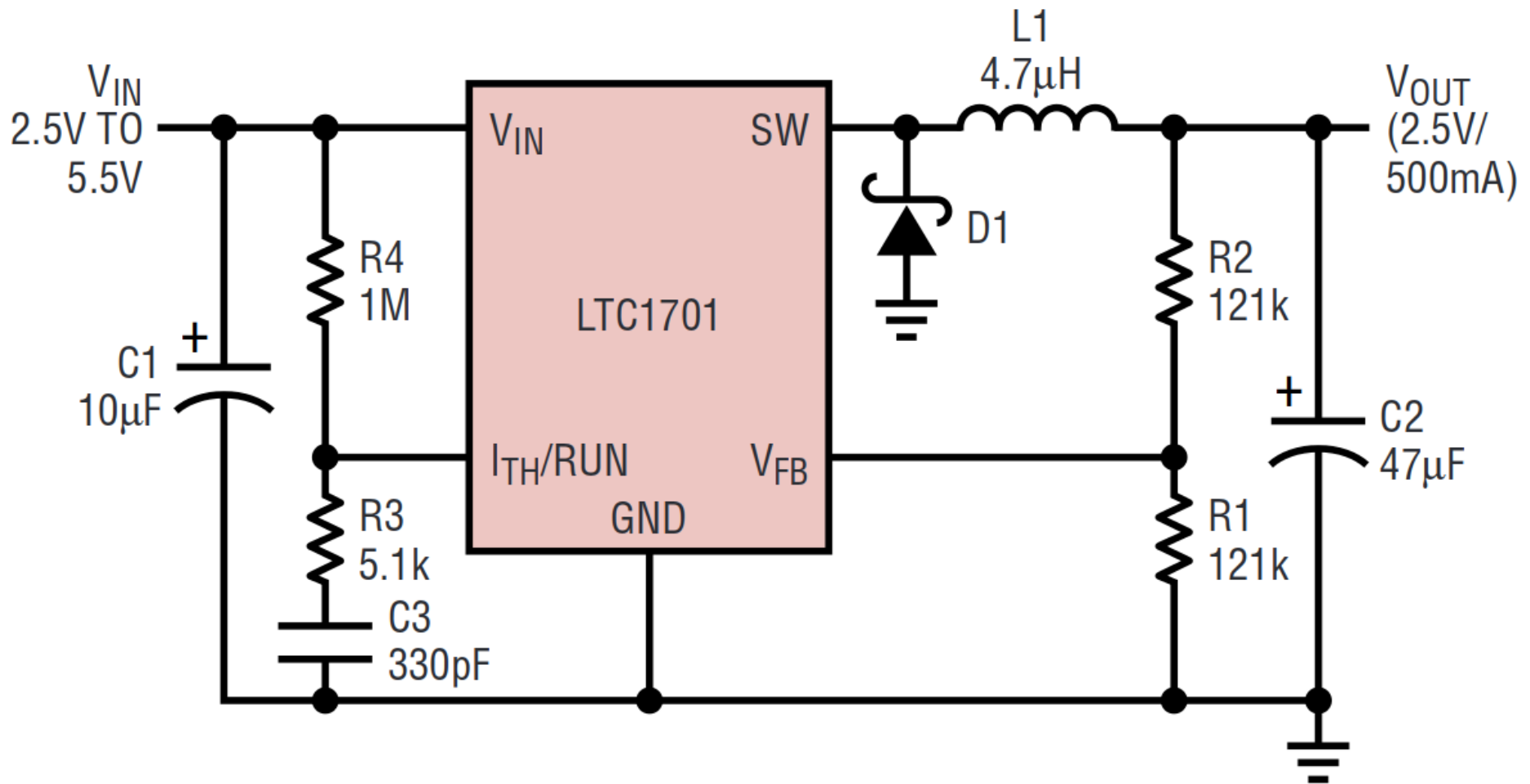
Exemples d'alimentations

• Exemple : boost (LM2735)



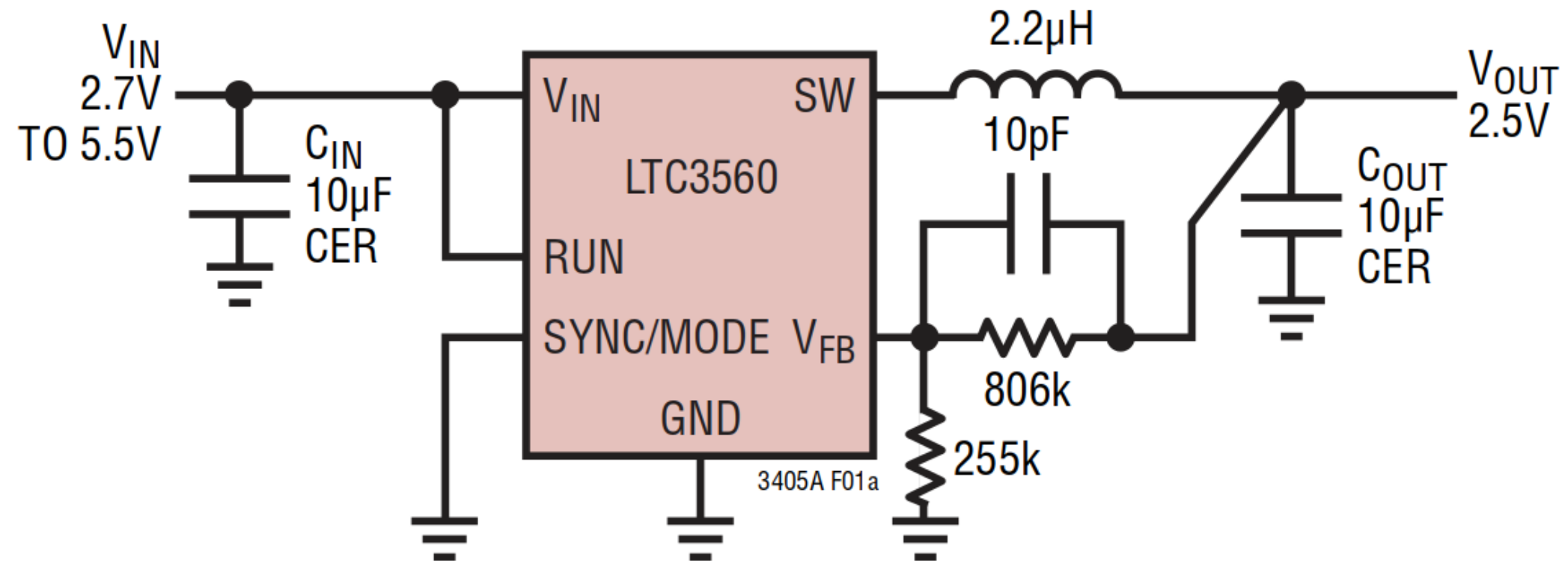
Exemples d'alimentations

• Exemple : buck asynchrone (LTC1701)



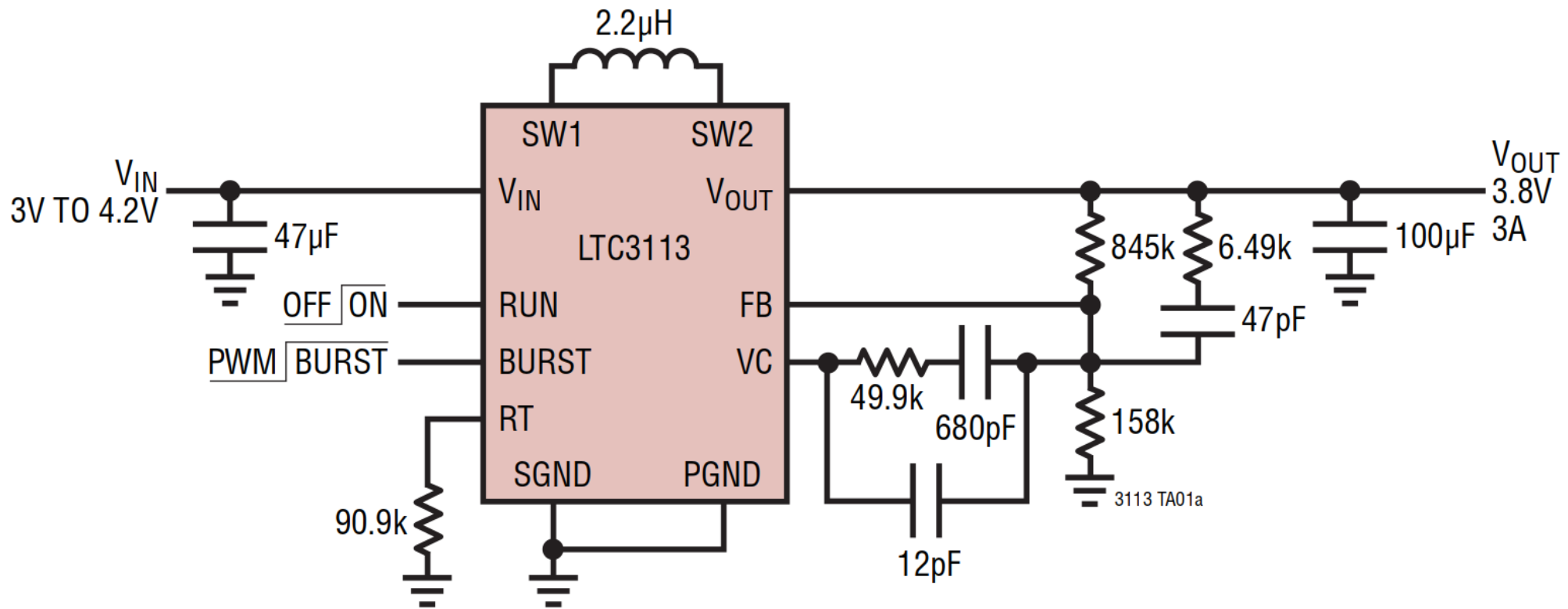
Exemples d'alimentations

- Exemple : buck synchrone (LTC3560)



Exemples d'alimentations

• Exemple : buck-boost (LTC3113)



Où en est-on ?



- **Les alimentations**



- **Ultra basse consommation**

- « Typical numbers »
- Capacité des batteries / IR
- Optimisations matérielles
- Optimisations mixtes
- Optimisation logicielles

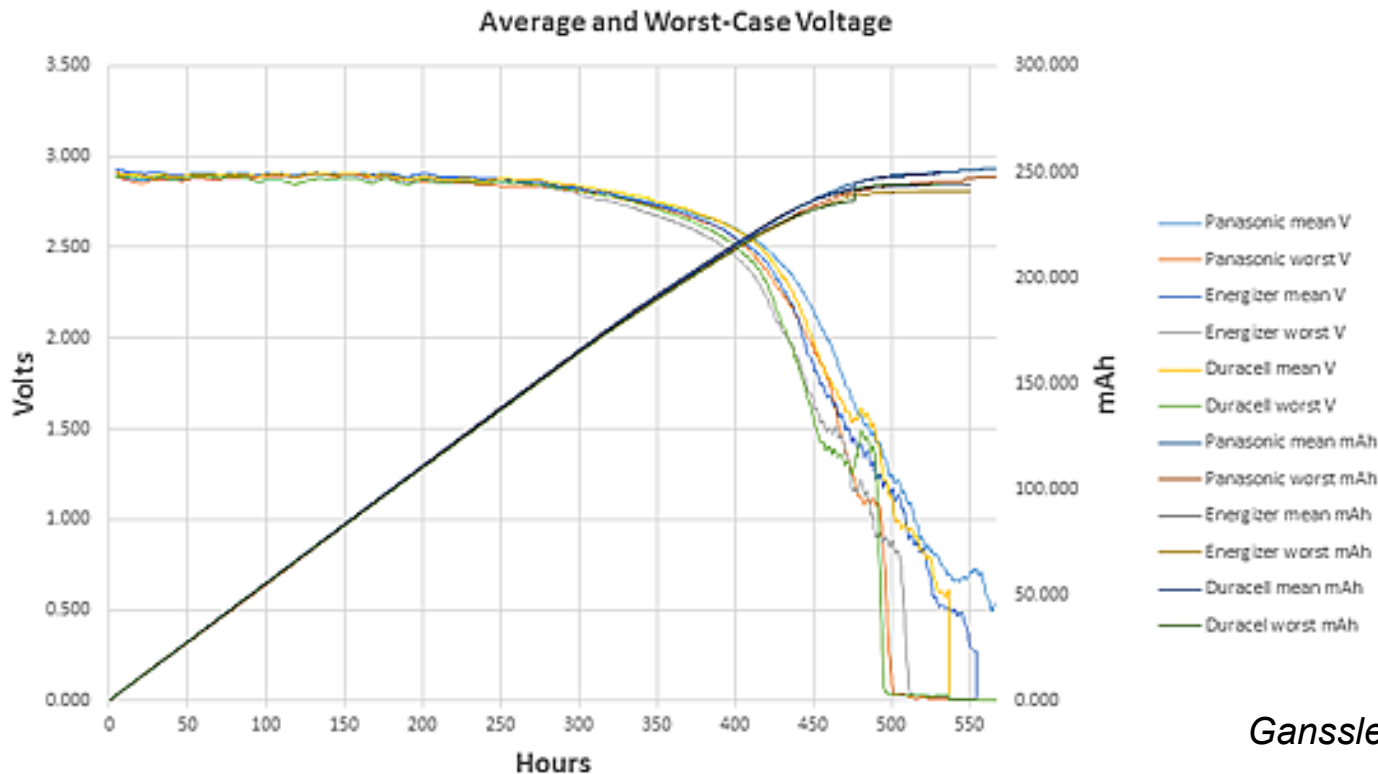
• Introduction

- Ère des objets connectés
 - Batteries : recharges les moins fréquentes possibles.
 - Piles : changements les moins fréquents possibles.
- Évolution :
 - Les microcontrôleurs consomment de moins en moins.
 - Les progrès sur les piles / batteries ne suivent pas.
 - Energy-harvesting
- Comment faire pour qu'un système consomme le moins possible ?

Piles CR2032

Caractéristiques

- Capacité d'environ 225mAh (à prendre avec des pincettes).
- Tension nominale : 3V.
- Tension de fin de vie : 2V.

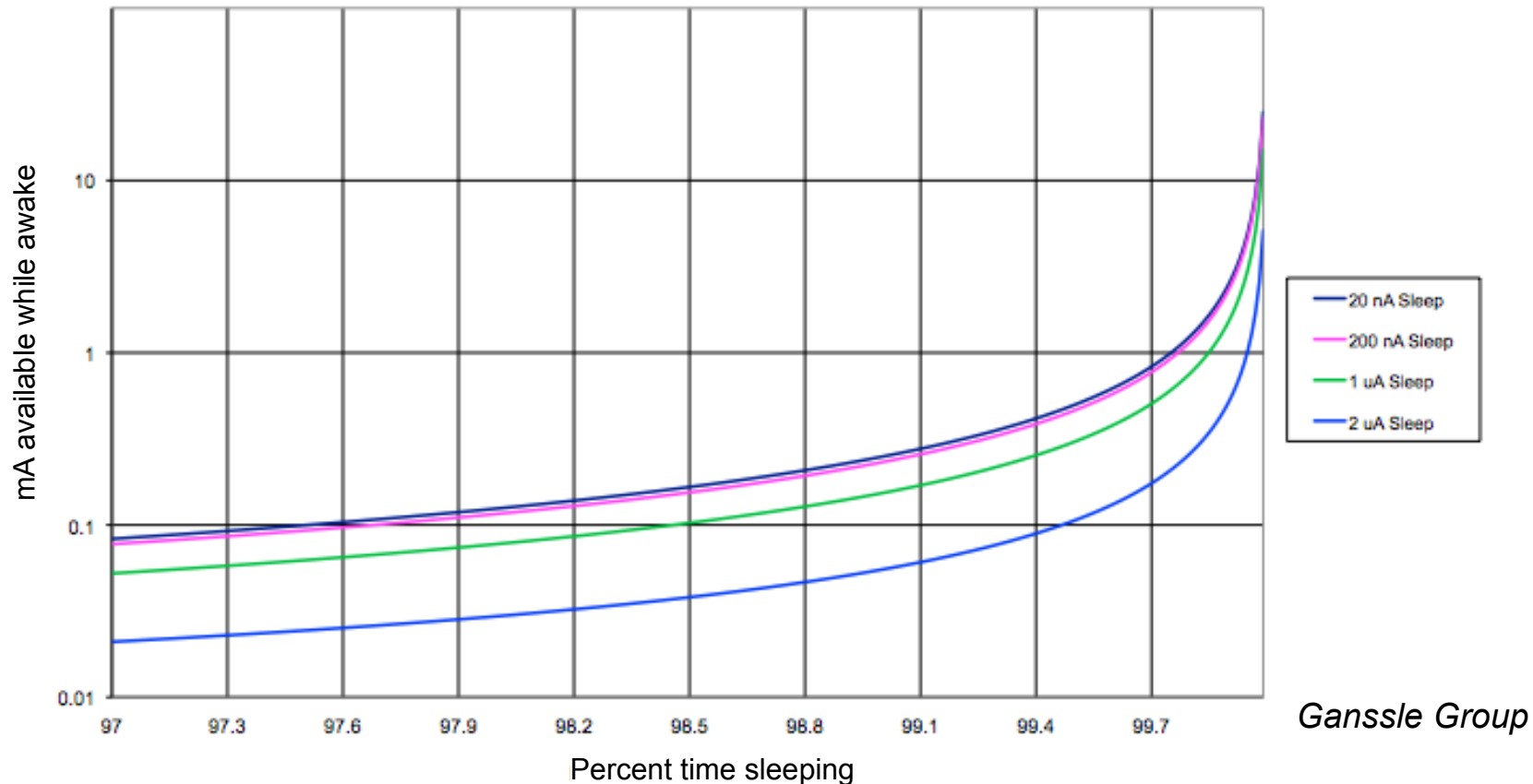


Décharge de 42 piles CR2032 de différents lots de différents constructeurs à 0.5mA.

Ganssle Group

Piles CR2032

- 225mAh \Rightarrow pour durer 10 ans, un système ne doit pas consommer en moyenne plus de $2.5\mu\text{A}$.
 - Il passera donc la majorité de son temps en veille !
 - Quelle est l'influence du courant de veille sur le courant disponible pour faire un travail utile ?

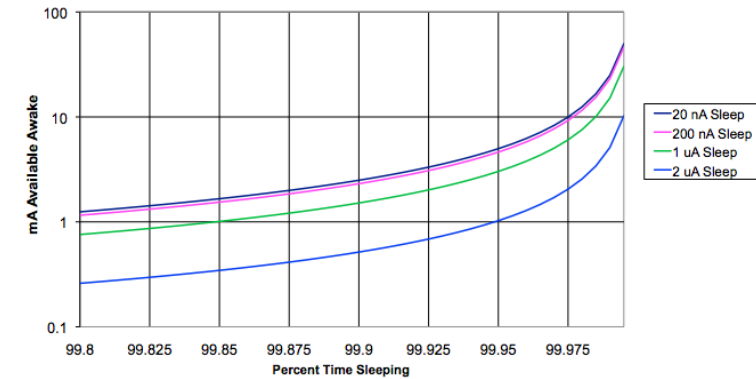


Ganssle Group

Piles CR2032

• Analyse :

- Le courant de veille est tellement faible, qu'entre deux systèmes consommant 20nA et 200nA en veille, la quantité de courant disponible pour faire du travail utile est quasiment la même tant qu'on dort au moins 95% du temps.
- Entre un système à 20nA et 1 μ A de veille, la différence est plus notable, mais moins qu'un facteur 5.



• Conclusion :

- Le courant de veille a une influence négligeable du moment qu'un système est en veille la plupart du temps.
- On s'attachera à ne jamais dépasser 2.5 μ A de courant de veille pour approcher le plus possible les 10 ans de vie.

Courant de veille

- Datasheets :

- Listent des valeurs typiques, minimales et maximale, le tout à différentes température.
- Que veulent dire ces nombres, lesquels prendre ?

- Exemples :

- Kinetis K60, Very-low-power stop mode current at 3.0 V
 - -40°C à 25°C : typical = 93µA, max = 435µA
 - 70°C : typical = 520µA, max = 2000µA
 - 105°C : typical = 1350µA, max = 4000µA
- Gecko EFM32ZG108, input leakage current :
 - typical = 0.1nA, max = 100nA
- STM32L151, current consumption in Stop mode
 - -40°C à 25°C : typical = 0.5µA, max = 2.2µA
 - 55°C : typical = 1.9µA, max = 5µA
 - 85°C : typical = 3.5µA, max = 8µA
 - 105°C : typical = 8.9µA, max = 20µA

Courant de veille

- Analyse :
 - Entre le meilleur et le pire cas, on trouve souvent un facteur de 200 !
 - La plupart des paramètres ne donnent pas de valeur maximale, juste des valeurs typiques.
- Que veut dire « typique » ?
 - ST : *Unless otherwise specified, typical data are based on $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.6\text{ V}$ (for the $1.65\text{ V} \leq V_{DD} \leq 3.6\text{ V}$ voltage range). They are given only as design guidelines and are not tested.*
 - Kinetis : *Typical values are provided as design guidelines and are neither tested nor guaranteed.*
 - Gecko : The typical data are based on $T_{AMB}=25^\circ\text{C}$ and $V_{DD}=3.0\text{V}$, as defined in Table 3.2(p.8), *by simulation and/or technology characterisation unless otherwise specified.*

- Que veut dire « maximal » ?

- ST : Unless otherwise specified the minimum and maximum values are guaranteed in the worst conditions of ambient temperature, supply voltage and frequencies by tests in production on 100% of the devices with an ambient temperature at $T_A = 25\text{ °C}$ and $T_A = T_{Amax}$ (given by the selected temperature range).

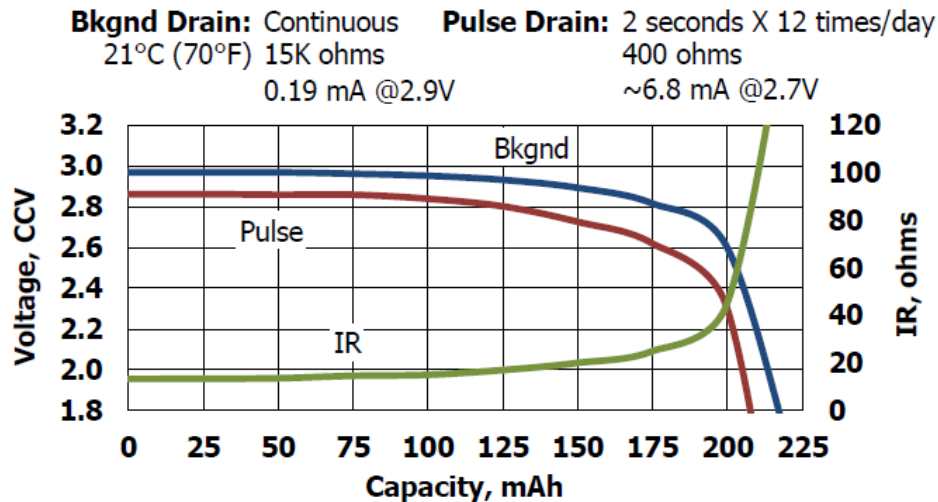
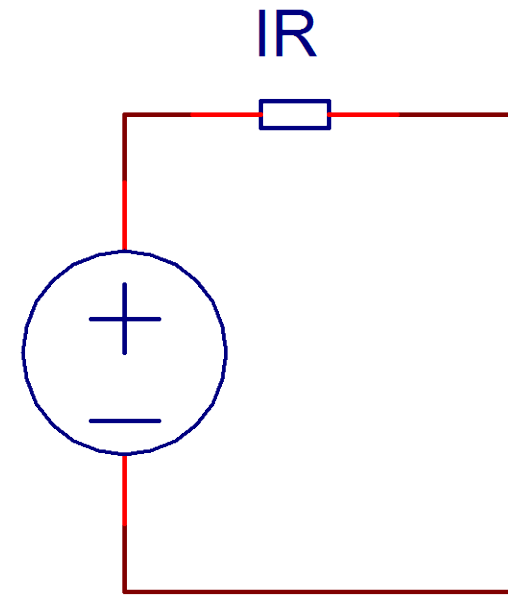
Data based on characterization results, design simulation and/or technology characteristics are indicated in the table footnotes and are not tested in production. Based on characterization, the minimum and maximum values refer to sample tests and represent the mean value plus or minus three times the standard deviation ($\text{mean} \pm 3\Sigma$).

- Gecko : The minimum and maximum values represent the worst conditions of ambient temperature, supply voltage and frequencies, as defined in Table 3.2 (p.8), by simulation and/or technology characterisation unless otherwise specified.
- Kinetis : The maximum values stated in the following table represent characterized results equivalent to the mean plus three times the standard deviation ($\text{mean} + 3\text{ sigma}$).

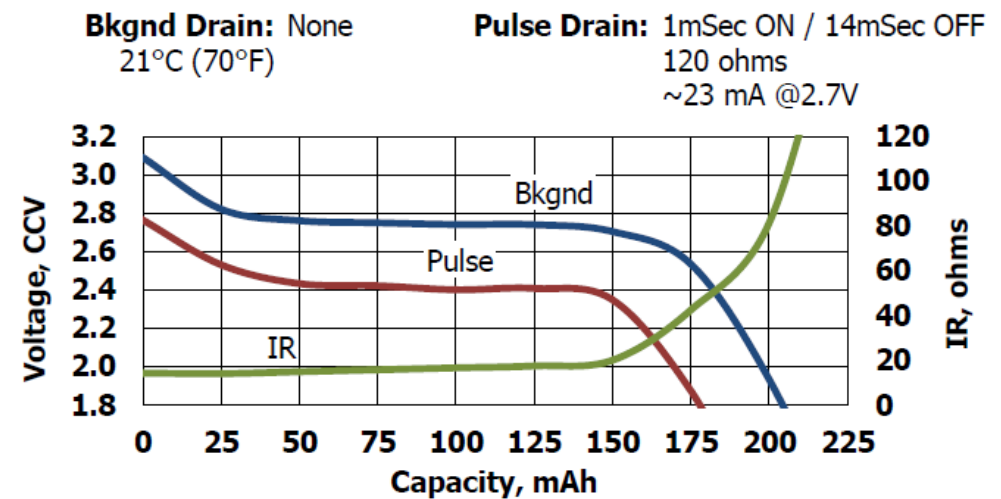
- Conclusion :
 - Valeurs typiques : ne veulent **RIEN** dire !
 - Seules les valeurs minimales et maximales sont des garanties, et encore... lire les restrictions à la fin des datasheets !
- Alors comment faire ?
 - Insister auprès des fournisseurs pour avoir des chiffres précis.
 - Mesurer plusieurs lots achetés chez des fournisseurs différents.

Retour sur les piles CR2032

- Modélisation
 - générateur de tension de 3V
 - résistance interne IR
 - environ 15 ohms à vide
 - variable lors de la vie de la batterie
- En réalité, pulse discharge :

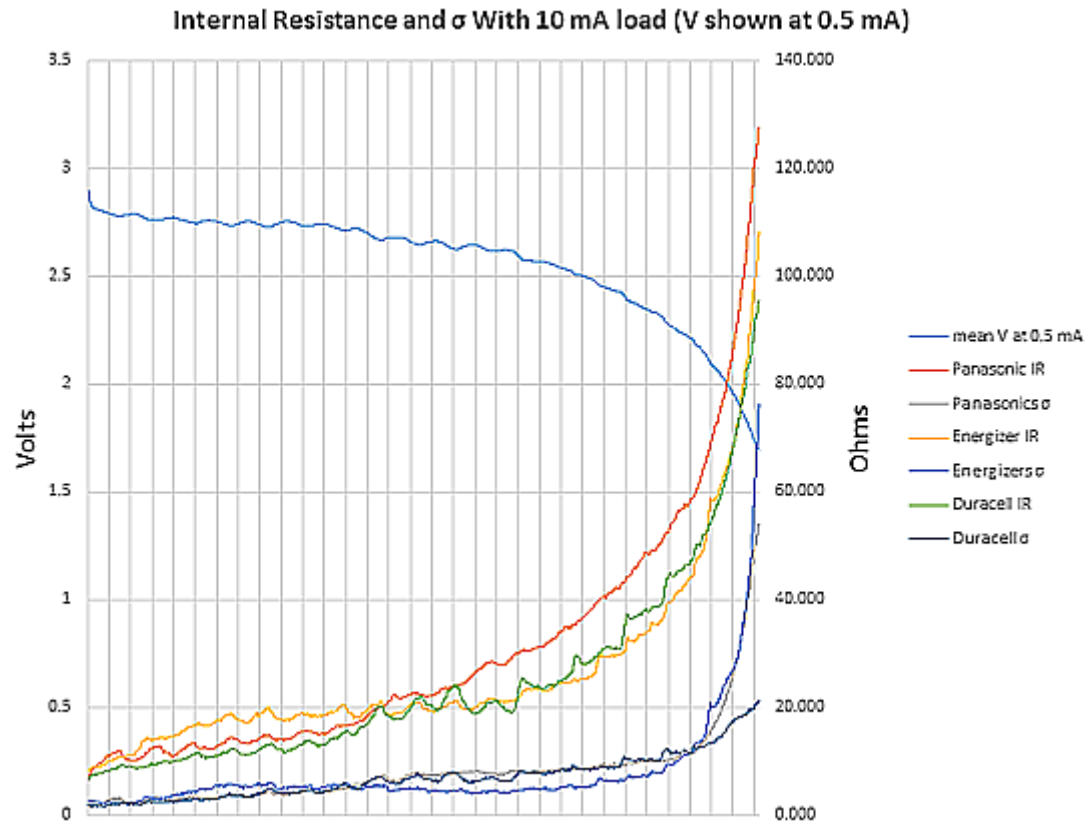


Energizer



Retour sur les piles CR2032

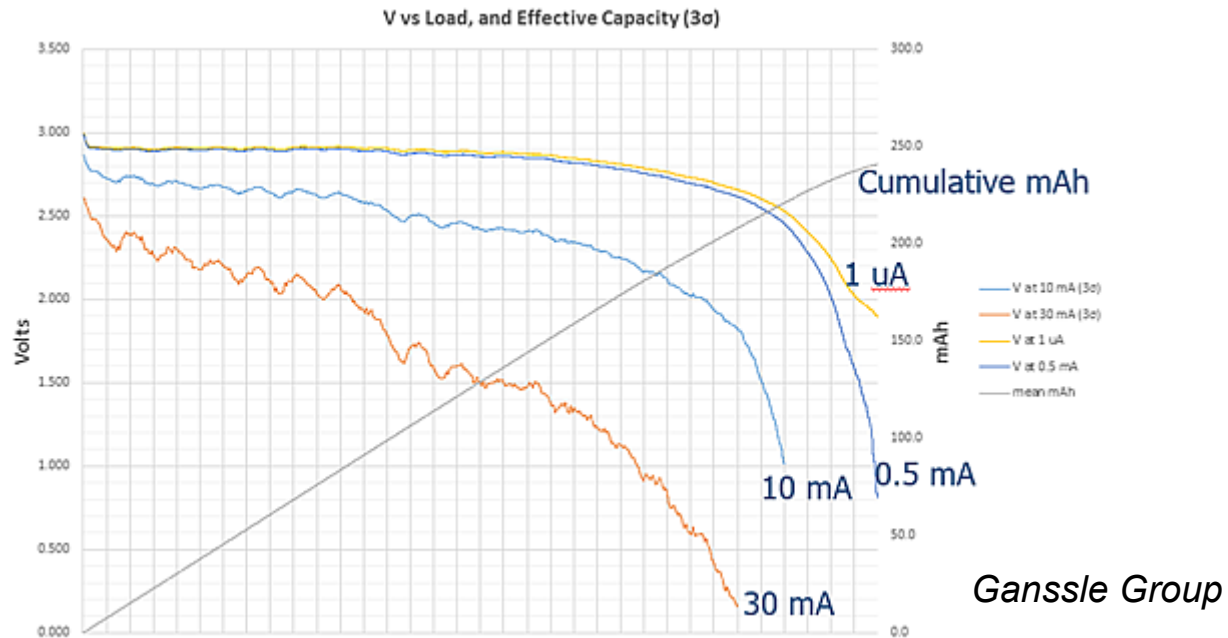
- Décharge à 10mA sur 3 modèles



Ganssle Group

Retour sur les piles CR2032

• Capacité réelle de la batterie



- Consommation d'un STM32L151 : 9.2mA @ 32MHz
- Consommation d'un nRF51822 :
 - CPU + flash : 4.1mA @ 16MHz
 - TX BLE : 16mA @0dB
 - RX BLE : 13mA
 - \Rightarrow plus que 30% de la capacité « normale » de la batterie !

Retour sur les piles CR2032

• Conclusion

- Les capacité des batteries sont données pour un certain courant de décharge (très faible).
- Au delà :
 - la capacité réelle de la batterie chute énormément,
 - la résistance interne de la batterie augmente énormément.
- Bien lire les datasheets des piles !
- Ne pas acheter de piles dont on ne connaît pas les caractéristiques exactes.

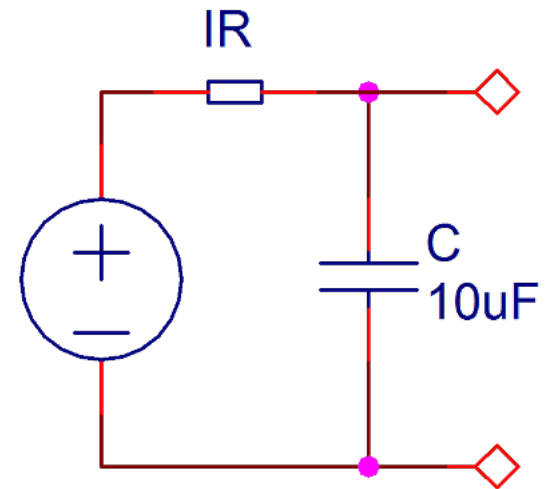
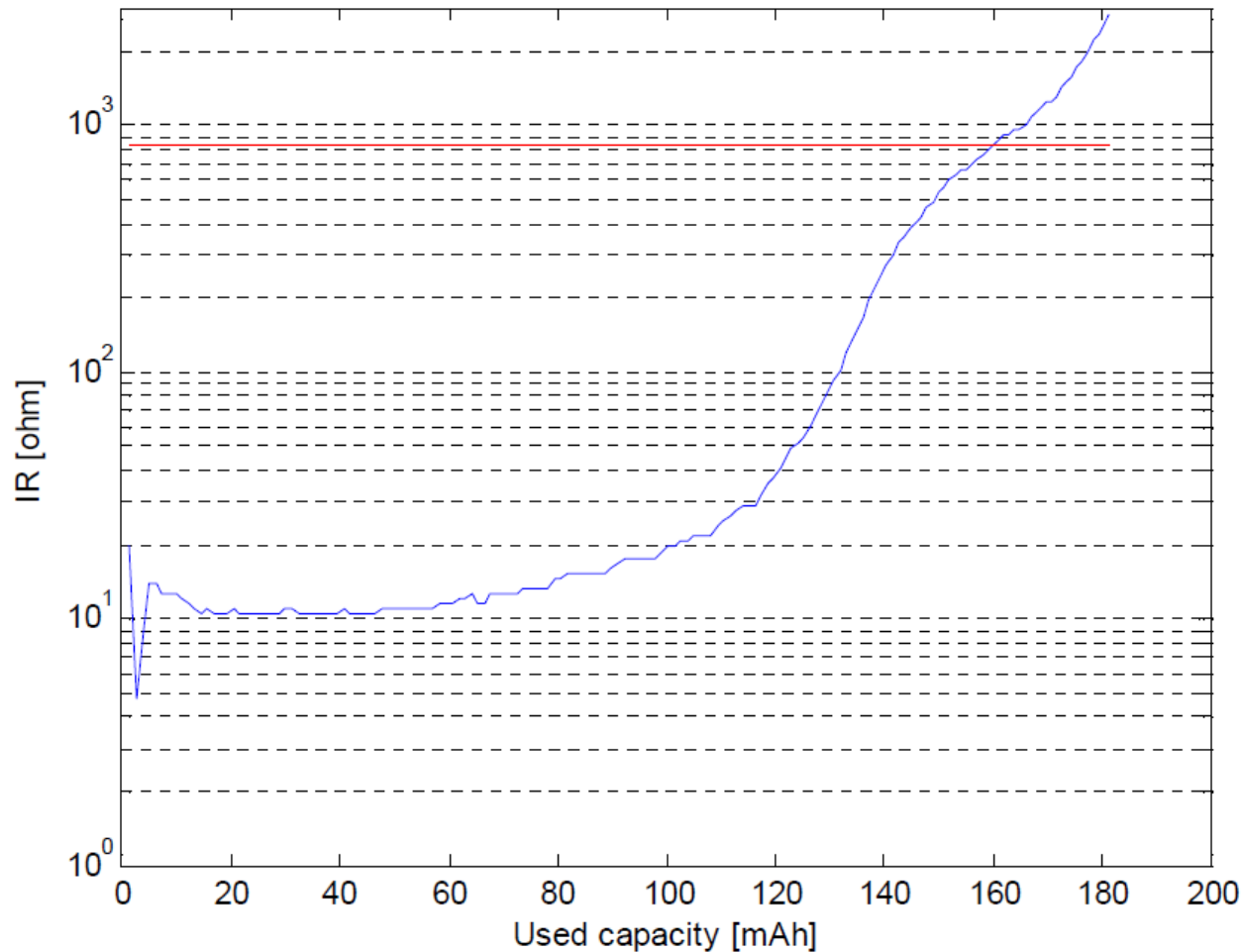
Optimisation matérielle

- Humidité, saleté, graisse, sel.
 - Ne croyez pas les légendes urbaines, mesurez !
 - Mesures du Ganssle Group avec et sans soldermask pour des pistes de 1cm de long.

| | Fuite sur 1cm sans Solder Mask | Fuite sur 1cm avec Solder Mask |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Humidité relative ambiante 80 % | 0.02 μA | trop faible |
| Crème pour les mains ! | 0.18 μA | trop faible |
| Graisse des doigts | <0.008 μA | trop faible |
| Graisse des doigts à 80% d'humidité relative | 0.065 μA | trop faible |
| Sel sec | 0.05 nA | trop faible |
| Sel à 80% d'humidité relative | 2 μA | trop faible |
| Rosine | 0.002 μA | - |

• Capacités de découplage

- Permettent de fournir des pointes de courant que l'alimentation ne pourrait pas fournir.

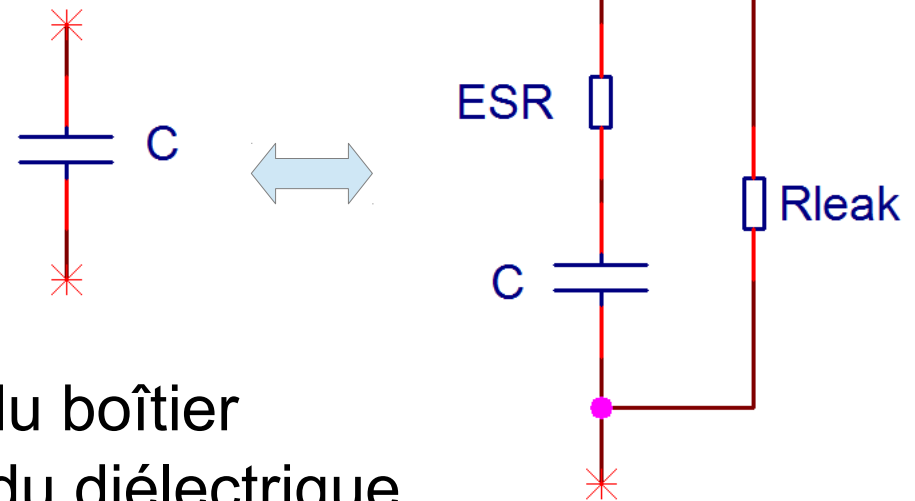


source : TI

Optimisation matérielle

- Capacités de découplage

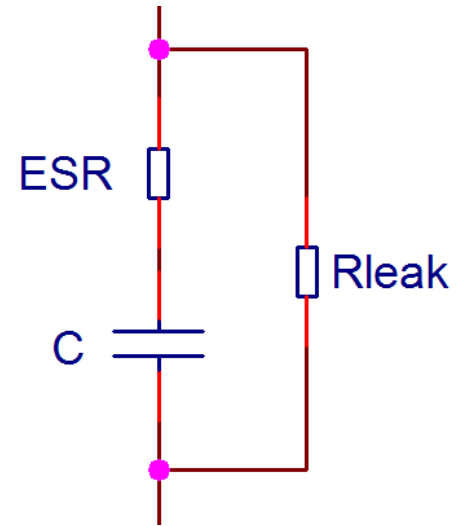
- ont des éléments parasites
 - résistance série : ESR
 - résistance de fuite : Rleak
 - inductance série : ESL



- ESL : dépend principalement du boîtier
- ESR : dépend principalement du diélectrique
- Rleak : dépend principalement du diélectrique et du boîtier

Optimisation matérielle

- Courant de fuite (leakage)
 - Varie comme la taille du boîtier.
 - Généralement donnée en Ohms.Farad.
- Diélectriques communs
 - Électrolytiques : courant de fuite énorme.
 - Tantales : courant de fuite grand.
 - Céramiques : courant de fuite faible.
- Le courant de fuite varie en fonction :
 - du temps,
 - de la tension à laquelle la capacité est utilisée.



Optimisation matérielle

• Électrolytiques (Kemet 180CPS)

| ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION | | | | | | | |
|--|---------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| U_R (V) | C_R (μ F) | NOMINAL CASE SIZE L x W x H (mm) | I_R 105 °C 100 kHz (mA) | I_{L2} 2 min (μ A) | $\tan \delta$ 100 Hz | Z 100 kHz 20 °C (Ω) | ORDERING CODE MAL2180... |
| 16 | 39 | 5.3 x 5.3 x 5.7 | 2350 | 300 | 0.12 | 0.020 | 97501E3 |
| | 39 | 6.6 x 6.6 x 5.9 | 2460 | 300 | 0.12 | 0.024 | 97502E3 |
| | 68 | 6.6 x 6.6 x 5.9 | 2440 | 300 | 0.12 | 0.025 | 97503E3 |
| | 100 | 6.6 x 6.6 x 5.9 | 2490 | 320 | 0.12 | 0.024 | 97504E3 |
| | 150 | 8.4 x 8.4 x 6.7 | 3220 | 500 | 0.12 | 0.022 | 97505E3 |
| | 220 | 10.4 x 10.4 x 7.7 | 3450 | 704 | 0.12 | 0.022 | 97506E3 |
| | 270 | 8.4 x 8.4 x 12 | 4850 | 864 | 0.15 | 0.012 | 97507E3 |
| | 330 | 10.4 x 10.4 x 12.6 | 5300 | 1056 | 0.15 | 0.012 | 97508E3 |
| | 470 | 10.4 x 10.4 x 12.6 | 6100 | 1504 | 0.15 | 0.010 | 97509E3 |
| | 820 | 10.4 x 10.4 x 12.6 | 5400 | 2624 | 0.12 | 0.012 | 97511E3 |
| 20 | 120 | 6.6 x 6.6 x 5.9 | 3200 | 480 | 0.12 | 0.025 | 97201E3 |
| | 390 | 8.4 x 8.4 x 12 | 4950 | 1560 | 0.12 | 0.014 | 97202E3 |
| | 560 | 10.4 x 10.4 x 12.6 | 5600 | 2240 | 0.12 | 0.012 | 97203E3 |

Optimisation matérielle

• Tantale

| Rated Voltage | Rated Capacitance | Case Code/ Case Size | KEMET Part Number | DC Leakage | DF | Standard ESR | | Low ESR | | Maximum Operating Temp |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| VDC at 85°C | μF | KEMET/EIA | (See below for part options) | μA at +25°C Maximum/ 5 Minutes | % at +25°C 120 Hz Maximum | mΩ at +25°C 100 kHz Maximum | E-Spec Code | mΩ at +25°C 100 kHz Maximum | E-Spec Code | °C |
| 6.3 | 10 | B/3528-21 | T489B106(1)006A(2) | 0.5 | 6.0 | 3000 | E3K0 | | | 125 |
| 6.3 | 15 | A/3216-18 | T489A156(1)006A(2) | 0.7 | 6.0 | 2030 | E2K0 | 1500 | E1K5 | 125 |
| 6.3 | 22 | C/6032-28 | T489C226(1)006A(2) | 1.0 | 6.0 | 2000 | E2K0 | | | 125 |
| 6.3 | 47 | B/3528-21 | T489B476(1)006A(2) | 2.2 | 6.0 | 1620 | E1K6 | 500 | E500 | 125 |
| 6.3 | 150 | B/3528-21 | T489B157(1)006A(2) | 7.1 | 15.0 | 3000 | E3K0 | | | 125 |
| 6.3 | 100 | C/6032-28 | T489C107(1)006A(2) | 4.7 | 6.0 | 440 | E440 | | | 125 |
| 6.3 | 150 | C/6032-28 | T489C157(1)006A(2) | 7.1 | 8.0 | 500 | E500 | 300 | E300 | 125 |
| 6.3 | 100 | D/7343-31 | T489D107(1)006A(2) | 4.7 | 8.0 | 800 | E800 | | | 125 |
| 6.3 | 150 | D/7343-31 | T489D157(1)006A(2) | 7.1 | 6.0 | 400 | E400 | 150 | E150 | 125 |
| 6.3 | 220 | D/7343-31 | T489D227(1)006A(2) | 10.4 | 8.0 | 360 | E360 | 150 | E150 | 125 |
| 6.3 | 470 | X/7343-43 | T489X477(1)006A(2) | 22.2 | 8.0 | 250 | E250 | 200 | E200 | 125 |
| 6.3 | 680 | X/7343-43 | T489X687(1)006A(2) | 32.1 | 15.0 | 600 | E600 | | | 125 |

source : Kemet

Optimisation matérielle

- Céramiques multilayers (MLCC)

| EIA Case Size | 1,000 Megohm Microfarads or 100 GΩ | 100 Megohm Microfarads or 10 GΩ |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 0603 | N/A | All |
| 0805 | < 0.0039 μF | ≥ 0.0039 μF |
| 1206 | < 0.012 μF | ≥ 0.012 μF |
| 1210 | < 0.033 μF | ≥ 0.033 μF |
| 1808 | < 0.018 μF | ≥ 0.018 μF |
| 1812 | < 0.027 μF | ≥ 0.027 μF |
| ≥ 1825 | All | N/A |

source : Kemet

| Vendor | Dielectric | Leakage spec | 100 uF leakage at 3 V | % of total available power consumed by the cap |
|---------|------------|----------------|--------------------------|---|
| TDK | Y5V | 100 ohm-farad | 3.0 uA | 120% |
| Kemet | Y5V | 50 ohm-farad | 6.0 uA | 240% |
| AVX | X7R | 1000 ohm-farad | 0.3 uA | 12% |
| Kemet | X7R | 500 ohm-farad | 0.6 uA | 24% |
| Samsung | X7R | 100 ohm-farad | 3.0 uA | 120% |

source : Ganssle Group

- Attention à la température et à la tension de fonctionnement !

• LED

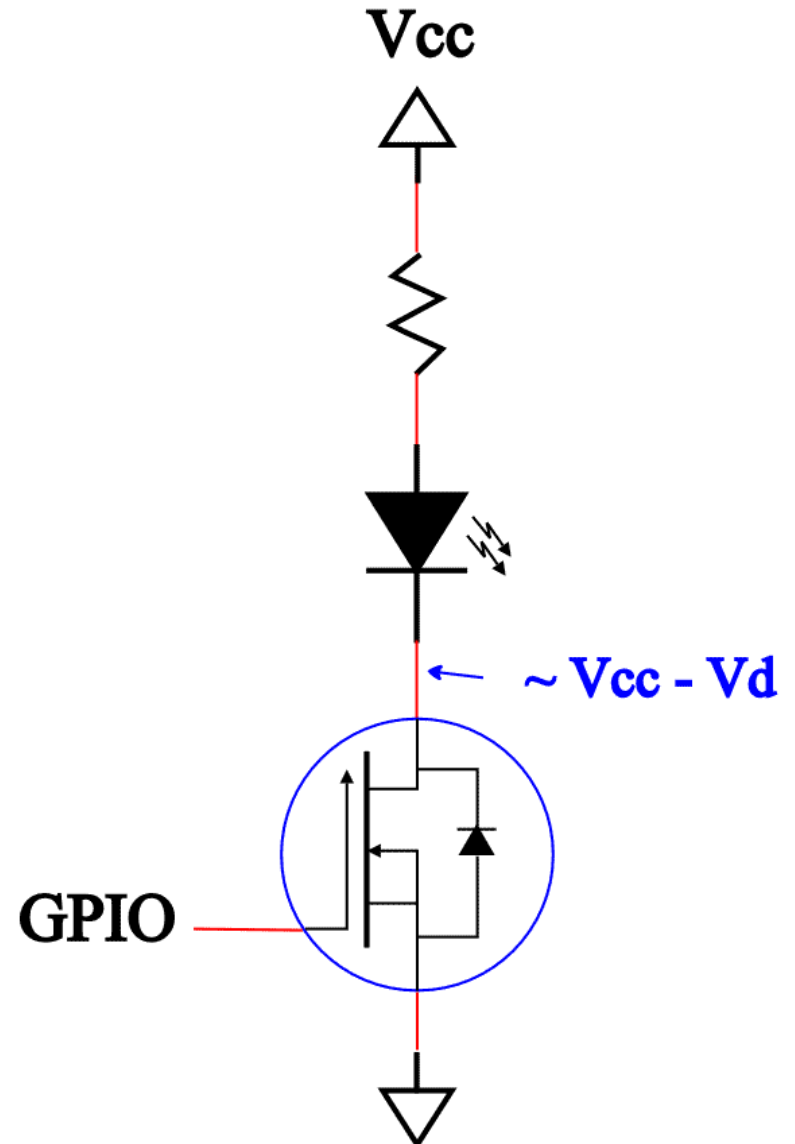
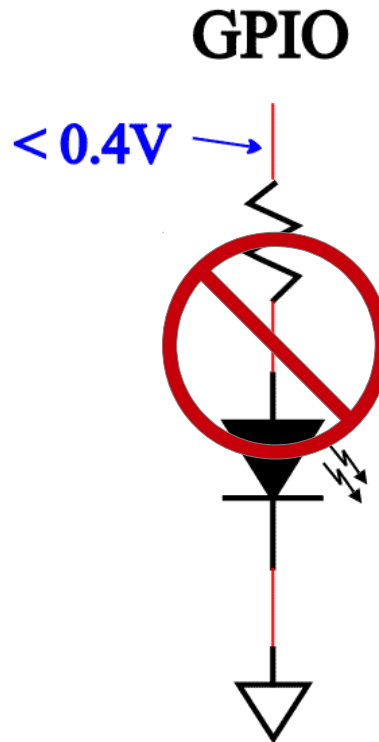
- Les LED sont spécifiées pour un courant maximum, souvent beaucoup plus grand que nécessaire.

• Optimisation

- LED haute luminosité
- PWM
 - 50% = 50% de gagné,
 - flash : quelques millisecondes suffisent.
- Éviter de piloter des LEDs par des GPIO :
 - les piloter à travers un transistor MOS.

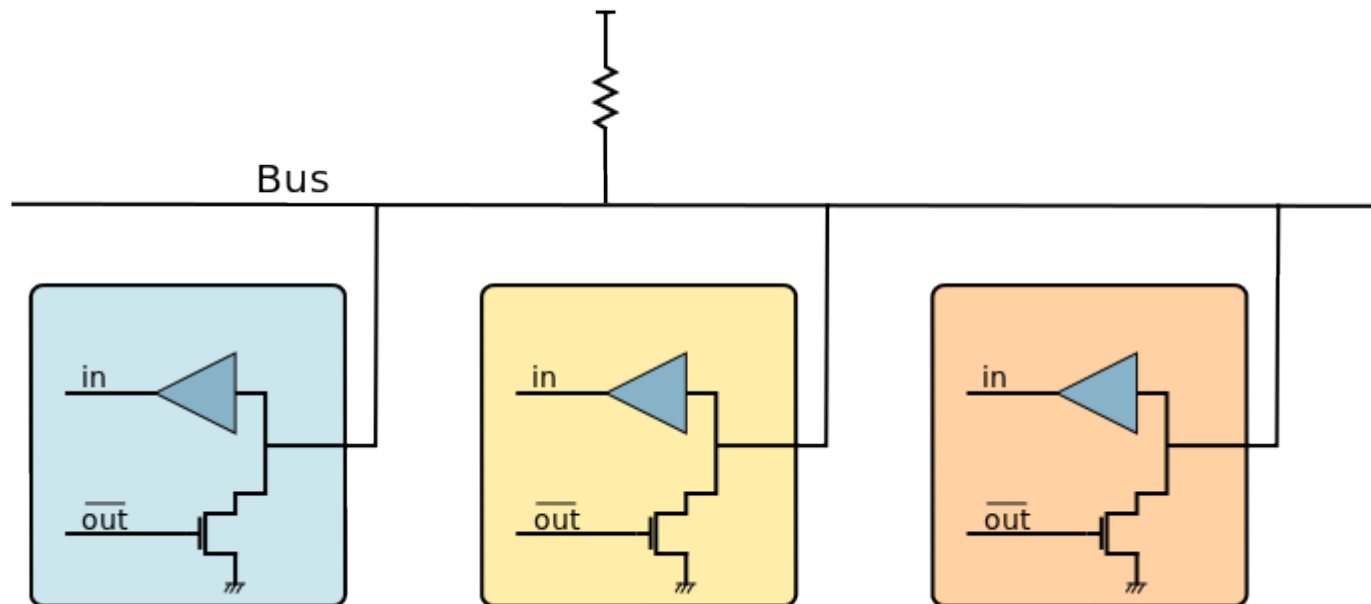
Optimisation matérielle

• LED

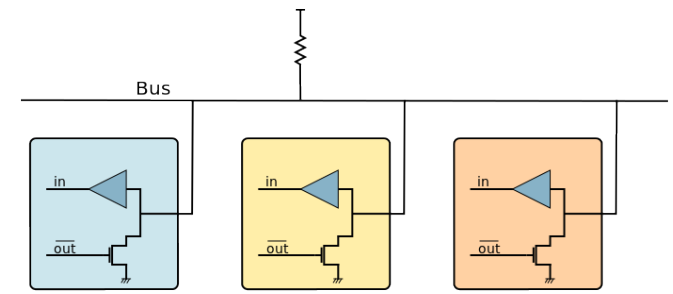


source : cMicroTek

- Transactions bidirectionnelles
 - drivers open drain (collecteur ouvert)
 - Évite, par construction, les court-circuits.
 - AND câblé.
 - Nécessite une résistance de rappel (pull-up)



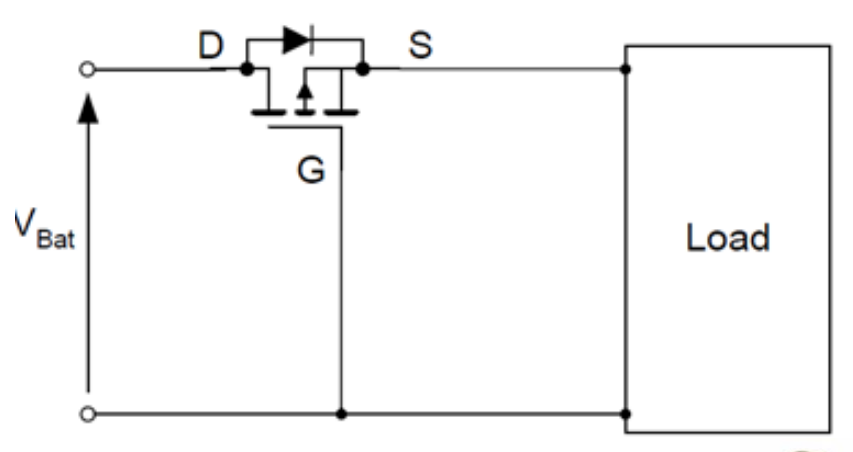
Optimisation matérielle



- Quelle valeur pour les pull-up ?
 - valeur minimale : courant admissible dans les drivers,
 - valeur maximale : rapidité des fronts.
- Attention :
 - un pull-up de 10k @ 3V consomme 300 μ A !
 - un pull-up de 100k @ 3V consomme 30 μ A !
- Conclusion :
 - éviter les pull-up / pull-down,
 - préférer des bus sans pull-up : SPI, UART, ...

Optimisation matérielle

- Protection contre l'inversion des batteries
 - Usuellement : diode schottky.
 - Mais tension de seuil souvent trop grande : 0.15 à 0.4V
- Solutions :
 - utilisation d'un PMOS en « diode idéale »



- utiliser un boîtier anti-inversion



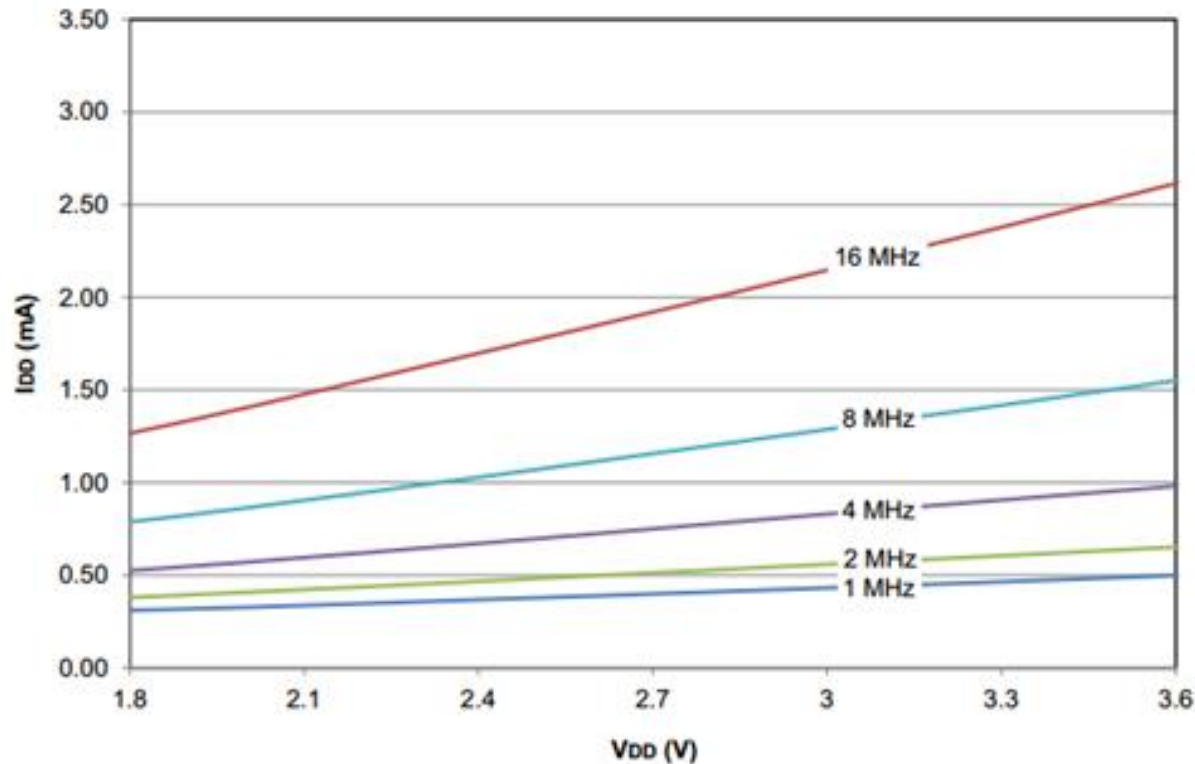
- Bien choisir son alimentation
 - Régulateurs à découpage :
 - Rendement excellent, sauf pour certaines topologies si courant faible.
 - Parfois mode spécial « courant de sortie faible »
 - Nécessitent une capacité d'entrée pour lisser les appels de courant
 - leakage
 - pointe de courant : IR augmente considérablement
 - Régulateurs linéaires :
 - Rendement moins bon
 - Ne nécessitent pas de capacité en entrée
 - Pas de régulateur
 - Beaucoup de circuits basse consommation acceptent des tensions d'entrée de 3.3V à 2.2V → ok pour une pile bouton !
 - Conclusion : tester !

Optimisation matérielle

- Éteindre les circuits qui ne servent à rien
 - Utiliser les enables si on en a à sa disposition.
 - Implémenter un dispositif de coupure d'alimentation sinon
 - Attention à ne pas envoyer de tension sur l'entrée d'un circuit non alimenté.
 - Attention aux capacités de découplage qui peuvent maintenir un circuit en semi-vie erratique : prévoir un circuit de décharge rapide.
 - Utiliser les fonctions low-power des périphériques
 - Exemple : IMU / accéléromètres

Optimisation mixte

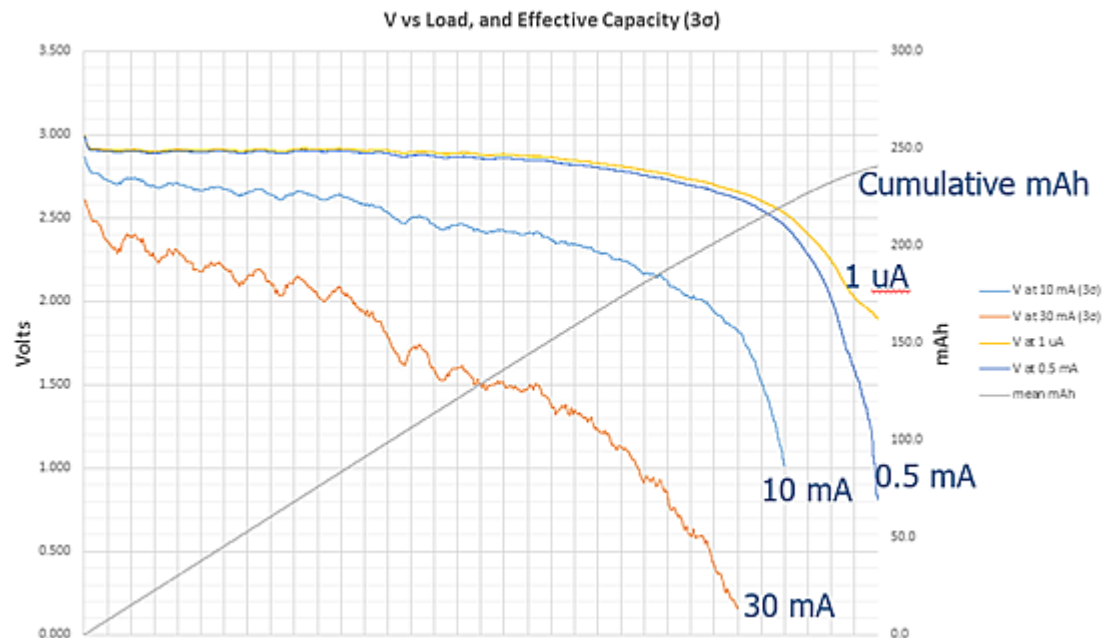
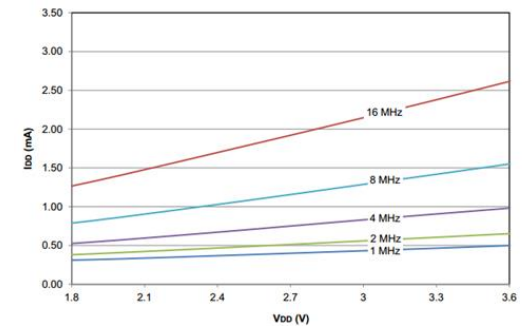
- Consommation théorique d'un circuit CMOS : $P \propto F \cdot C \cdot V^2$
 - Néglige la consommation statique.
 - En pratique : (MCU Microchip low power)



Optimisation mixte

Conclusion naïve :

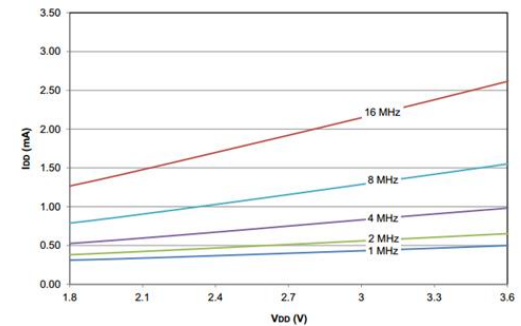
- Travailler à la fréquence la plus haute possible pour que ça dure le moins de temps possible.
- Oui mais non... Rappel : IR de la batterie



Optimisation mixte

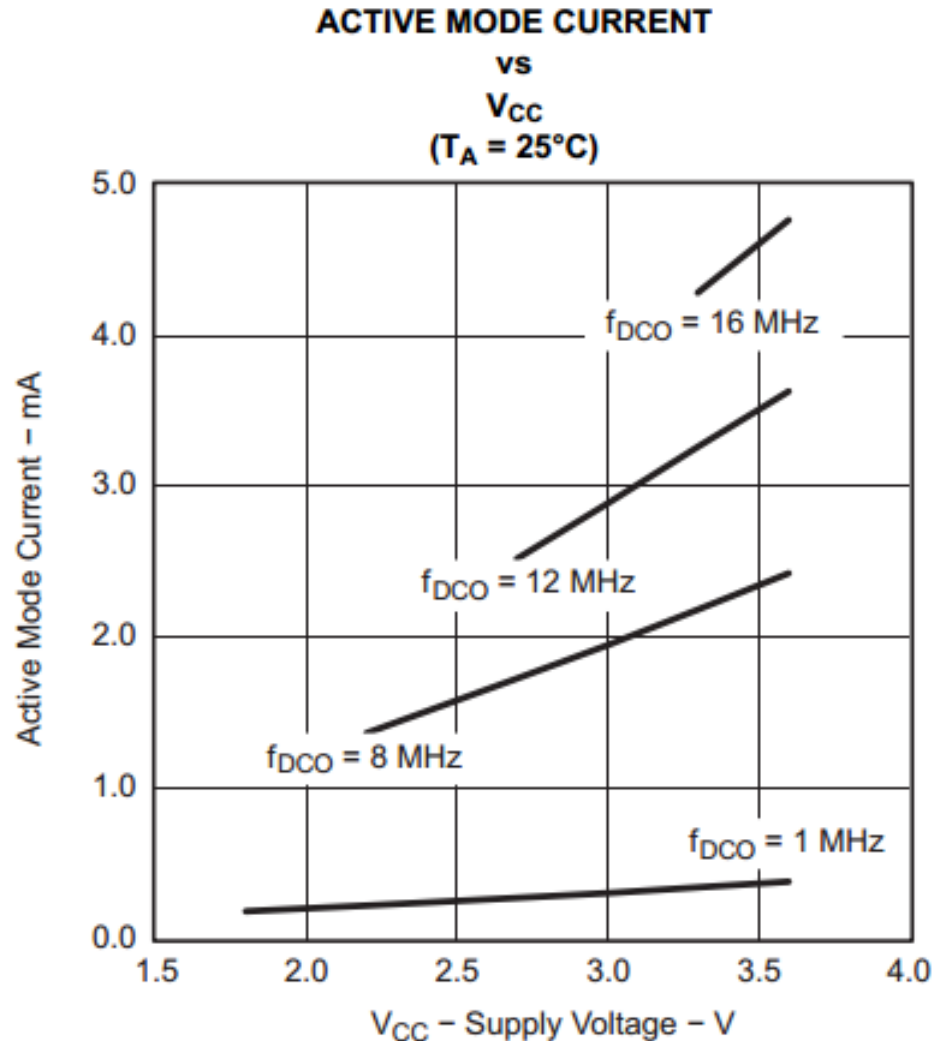
• Deux possibilités :

- Travailler à la fréquence la plus haute possible en prenant en compte l'IR le pire.
- Si les changements de fréquence peuvent se faire rapidement,
 - se réveiller à la fréquence la plus basse possible,
 - l'augmenter progressivement en mesurant la tension d'alimentation,
 - en tirant éventuellement partie de la courbe IR / capacité de la batterie si on les connaît.
- Phénomène de passivation
 - Parfois un appel brusque de courant peut faire chuter l'IR.
 - Veiller dans ce cas à ne pas faire rebooter le CPU...



Optimisation mixte

- Jouer sur VDD (exemple MSP430 de TI)



Optimisation mixte

- Jouer sur VDD :
 - Pas forcément simple à implémenter.
 - Si un système dort 99% du temps, le circuit additionnel consommera probablement plus que le gain attendu.
 - Utiliser un PMIC...

- Optimisations triviales :
 - Compiler en O3 !
 - Utiliser les fonctions inline.
 - Éviter le code relogeable (PIC).
 - Fonctionner le plus possible sous interruptions plutôt qu'en polling.
 - Exemples :
 - UART à 115200 sur processeur à 8MHz : 700 cycles / octets
 - UART à 19200 sur processeur à 8MHz : 4100 cycles / octets
 - Utiliser si possible les FIFO pour générer moins d'interruption.
 - Pour les gros transferts, utiliser le DMA de préférence aux boucles logicielles.
 - Tirer parti des OS : passer en veille dans l'idle-thread.
 - Périphériques non utilisés : les désactiver.
 - Périphériques utilisés : les faire fonctionner à la fréquence la plus basse possible.

• Timers :

- Faire fonctionner les timers le plus lentement possible.
- Utiliser la valeur de prédiviseur la plus grande possible :
 - un prédiviseur comptant sur moins de bits qu'un timer, il consomme moins.
- Utiliser la RTC si possible !

• UART :

- Certains UART disposent d'un prédiviseur fractionnel.
 - A souvent besoin d'une horloge 16 fois plus rapide qu'un diviseur entier.
 - Exemple : STM32F103

• GPIO

- Si on peut régler le slew rate, prendre celui le plus faible possible.
- Exemple : STM32, FPGA, ...
- Mettre les entrées inutilisées à la masse, sauf si la datasheet indique explicitement de faire autrement.

• Watchdogs

- Consomment de façon non négligeable.
- Or un processeur ne « plante » pas lorsqu'il dort.
- ⇒ désactiver les watchdogs à la mise en veille, les ré-activer au réveil !

- Modes « économie d'énergie »
 - Chaque constructeur a son propre jargon...
 - Plusieurs modes, désactivant de plus en plus de périphériques
- Attention :
 - Le passage de certains mode à d'autres peuvent prendre beaucoup de temps.
 - Certains modes ne sauvegardent pas la RAM !
 - Veiller aux conditions permettant de sortir de chaque mode :
 - IRQ sur périphérique standard (UART, timer)
 - IRQ sur broche dédiée (WAKEUP)
 - Attention aux capacités de découplage des modes « ultra-basse consommation »
 - Exemple : STM32

• Calculs flottants

- Toujours se demander si on a vraiment besoin de flottants.
 - Dans la plupart des cas, on a en fait besoin de virgule fixe.
- Les coprocesseurs flottants basse-consommation consomment maintenant souvent moins que les calculs émulés :
 - Berkeley SoftFloat sur ARM Cortex 32bits
 - 120 cycles / addition
 - 100 cycles / multiplication
 - 140 cycles / division
- Penser aux optimisations simples :
 - Fonctions trigonométriques : tables de lookup, CORDIC
 - Formules approchées (atan2, ...)

• Calculs flottants

| Function | Qfplib cycles | GCC library cycles |
|----------------|---------------|--------------------|
| qfp_fadd | 150 | 102 |
| qfp_fsub | 151 | 108 |
| qfp_fmul | 165 | 166 |
| qfp_fdiv | 323 | 475 |
| qfp_fdiv_fast | 187 | - |
| qfp_fcmp | 27 | - |
| qfp_fcos | 595 | 3350 |
| qfp_fsin | 585 | 3300 |
| qfp_ftan | 767 | 6140 |
| qfp_fatan2 | 718 | 4930 |
| qfp_fexp | 557 | 1930 |
| qfp_fln | 829 | 3960 |
| qfp_fsqrt | 738 | 460 |
| qfp_fsqrt_fast | 161 | - |

- *Low Power Design*
 - cMicroTek
 - http://www.cmicrotek.com/LPD_book.pdf

- *Hardware and Firmware Issues in Using Ultra-Low Power MCU*
 - The Ganssle Group
 - <http://www.ganssle.com/reports/ultra-low-power-design.html>

- Datasheets / Application notes de différents constructeurs
 - ST, NXP, Kemet, AVX, Panasonic, Energiser, ...

Licence de droits d'usage



Contexte académique } sans modification

Par le téléchargement ou la consultation de ce document, l'utilisateur accepte la licence d'utilisation qui y est attachée, telle que détaillée dans les dispositions suivantes, et s'engage à la respecter intégralement.

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage sur le document consulté ou téléchargé, totalement ou en partie, dans les conditions définies ci-après, et à l'exclusion de toute utilisation commerciale.

Le droit d'usage défini par la licence autorise un usage dans un cadre académique, par un utilisateur donnant des cours dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur et à l'exclusion expresse des formations commerciales et notamment de formation continue. Ce droit comprend :

- le droit de reproduire tout ou partie du document sur support informatique ou papier,
- le droit de diffuser tout ou partie du document à destination des élèves ou étudiants.

Aucune modification du document dans son contenu, sa forme ou sa présentation n'est autorisée.

Les mentions relatives à la source du document et/ou à son auteur doivent être conservées dans leur intégralité.

Le droit d'usage défini par la licence est personnel, non exclusif et non transmissible.

Tout autre usage que ceux prévus par la licence est soumis à autorisation préalable et expresse de l'auteur :

alexis.polti@telecom-paristech.fr